

Dell Precision 5750

서비스 매뉴얼

참고, 주의 및 경고

 **노트:** 참고"는 제품을 보다 효율적으로 사용하는 데 도움이 되는 중요 정보를 제공합니다.

 **주의:** 주의사항은 하드웨어의 손상 또는 데이터 유실 위험을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.

 **경고:** 경고는 재산 손실, 신체적 상해 또는 사망 위험이 있음을 알려줍니다.

장 1: 컴퓨터에서 작업하기	5
안전 지침.....	5
컴퓨터 내부 작업.....	5
컴퓨터 내부 작업을 마친 후에.....	7
장 2: 기술 및 구성 요소	8
USB 기능.....	8
USB Type-C.....	9
HDMI 1.4a.....	11
지문 인식기가 있는 전원 켜기 및 LED 동작.....	12
장 3: 분해 및 재조립	14
베이스 덮개.....	14
베이스 커버 제거.....	14
베이스 커버 설치.....	16
배터리.....	17
배터리 제거.....	17
배터리 설치.....	18
메모리 모듈.....	19
메모리 모듈 제거.....	19
메모리 모듈 설치.....	20
SSD1 슬롯의 솔리드 스테이트 드라이브.....	22
SSD1 슬롯에서 M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 제거.....	22
SSD1 슬롯에 M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 설치.....	22
SSD1 슬롯에서 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브 제거.....	23
SSD1 슬롯에 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브 설치.....	24
SSD2 슬롯의 솔리드 스테이트 드라이브.....	25
SSD2 슬롯에서 M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 제거.....	25
SSD2 슬롯에 M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 설치.....	26
SSD2 슬롯에서 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브 제거.....	27
SSD2 슬롯에 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브 설치.....	28
팬.....	29
팬 1 제거.....	29
오른쪽 팬 설치.....	30
팬 2 제거.....	31
왼쪽 팬 설치.....	32
방열판.....	33
방열판 제거(통합형 그래픽 카드와 함께 제공되는 컴퓨터에 해당).....	33
방열판 설치(통합형 그래픽 카드와 함께 제공되는 컴퓨터에 해당).....	34
방열판 제거.....	35
방열판 설치.....	36
I/O 보드.....	37
I/O 보드 제거.....	37
I/O 보드 설치.....	38

디스플레이 어셈블리.....	39
디스플레이 어셈블리 제거.....	39
디스플레이 어셈블리 설치.....	41
시스템 보드.....	44
시스템 보드 제거.....	44
시스템 보드 설치.....	47
안테나.....	50
안테나 제거.....	50
안테나 설치.....	51
손목 받침대 및 키보드 어셈블리.....	53
팜레스트 및 키보드 어셈블리 제거.....	53
팜레스트 및 키보드 어셈블리 설치.....	54
장 4: 문제 해결.....	56
SupportAssist 진단.....	56
시스템 진단 표시등.....	56
시스템 보드 M-BIST(Built-in Self Test).....	57
운영 체제 복구.....	57
BIOS 플래싱.....	58
BIOS 플래시(USB 키).....	58
백업 미디어 및 복구 옵션.....	58
Wi-Fi 전원 주기.....	59
잔류 전원 방출.....	59
장 5: 도움말 보기.....	60
Dell에 문의하기.....	60

컴퓨터에서 작업하기

안전 지침

컴퓨터의 손상을 방지하고 안전하게 작업하기 위해 다음 안전 지침을 따르십시오. 달리 명시되지 않는 한, 본 문서에 포함된 각 절차에서는 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽었음을 전제로 설명합니다.

- ① **노트:** 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 숙지하십시오. 추가 안전 모범 사례는 Regulatory Compliance(규정 준수) 홈페이지(www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오.
- ① **노트:** 컴퓨터 커버 및 패널을 열기 전에 모든 전원에서 컴퓨터를 연결 해제합니다. 컴퓨터 내부에서 작업한 후 컴퓨터를 전기 콘센트에 연결하기 전에 커버, 패널 및 나사를 모두 장착합니다.
- △ **주의:** 컴퓨터의 손상을 방지하려면 작업 표면이 평평하고 건조하고 깨끗한지 확인합니다.
- △ **주의:** 구성 요소 및 카드의 손상을 방지하려면 구성 요소 및 카드의 핀이나 단자를 잡지 말고 모서리를 잡습니다.
- △ **주의:** Dell 기술 지원 팀에서 승인하거나 지시한 경우에만 문제 해결 및 수리 작업을 수행해야 합니다. Dell사에서 공인하지 않은 서비스로 인한 손상에 대해서는 보상하지 않습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침 또는 www.dell.com/regulatory_compliance의 지침을 참조하십시오.
- △ **주의:** 컴퓨터 내부의 부품을 만지기 전에 컴퓨터 뒷면 금속처럼 도색되지 않은 금속 표면을 만져 접지하십시오. 작업하는 동안 컴퓨터의 도색되지 않은 금속 표면을 주기적으로 만져 내부 구성 요소를 손상시킬 수 있는 정전기를 제거하십시오.
- △ **주의:** 케이블을 연결 해제할 때는 케이블을 직접 잡아 당기지 말고 커넥터나 당김 탭을 잡아 당깁니다. 일부 케이블에는 잠금 탭이나 손잡이 나사가 있는 커넥터가 달려 있으므로 이와 같은 종류의 케이블을 분리하기 전에 이러한 탭이나 손잡이를 해제해야 합니다. 케이블을 연결 해제할 때는 커넥터 핀이 구부러지지 않도록 평평하게 정렬합니다. 케이블을 연결할 때는 포트 및 커넥터가 올바른 방향으로 정렬되었는지 확인하십시오.
- △ **주의:** 매체 카드 판독기에서 설치된 카드를 모두 눌러 꺼냅니다.
- ① **노트:** 컴퓨터와 특정 구성 요소의 색상은 이 설명서와 다를 수도 있습니다.

컴퓨터 내부 작업

컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에

이 작업 정보

- ① **노트:** 이 문서의 이미지는 주문한 컴퓨터의 구성에 따라 조금씩 다를 수 있습니다.

단계

1. 열려 있는 파일을 모두 저장하고 닫은 다음 사용 중인 응용 프로그램을 모두 종료합니다.
2. 컴퓨터를 종료하십시오. **Start > Power > Shut down**을 클릭합니다.
 - ① **노트:** 다른 운영 체제를 사용하고 있는 경우 해당 운영 체제의 설명서에서 종료 지침을 참조하십시오.
3. 컴퓨터 및 모든 연결된 디바이스를 전원 콘센트에서 연결 해제하십시오.
4. 키보드, 마우스, 모니터 등과 같은 연결된 모든 네트워크 디바이스 및 주변 장치를 컴퓨터에서 연결 해제합니다.

주의: 네트워크 케이블을 분리하려면 먼저 컴퓨터에서 케이블을 분리한 다음 네트워크 디바이스에서 케이블을 연결 해제합니다.

5. 해당하는 경우, 모든 미디어 카드 및 광학 디스크를 컴퓨터에서 분리합니다.

정전기 방전 - ESD 방지

ESD는 확장 카드, 프로세서, 메모리 DIMM, 시스템 보드와 같이 민감한 전자 구성 요소를 다룰 때 아주 중요한 부분입니다. 너무 짧은 시간으로 충전할 경우 간헐적인 문제 또는 제품 수명 단축 등 원인 불명으로 회로가 손상될 수 있습니다. 업계에서 전력 요구 사항의 완화와 집적도 향상을 요구함에 따라 ESD 보호에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

최근 Dell 제품에 사용된 반도체의 집적도 향상으로 인해 정전기로 인한 손상 정도가 이전 Dell 제품에 비해 높아짐에 따라 일부 부품 처리에 승인된 이전 방법이 더 이상 적용되지 않게 되었습니다.

두 가지 대표적인 ESD 손상 유형으로는 치명적인 오류와 간헐적으로 발생하는 오류가 있습니다.

- **치명적인 오류** - 이러한 오류는 ESD 관련 오류의 약 20%를 차지합니다. 장치 기능이 즉각적으로 완전히 손실되는 오류입니다. 정전기 충격을 받은 메모리 DIMM, 메모리가 누락되었거나 작동하지 않을 경우 비프음 코드와 함께 "POST 실행 안 됨/화면이 표시되지 않음(No POST/No Video)" 증상이 생성되는 오류 등이 치명적인 오류에 해당됩니다.
- **간헐적으로 발생하는 오류** - 이러한 오류는 ESD 관련 오류의 약 80%를 차지합니다. 간헐적인 오류의 비율이 높다는 것은 손상이 발생했을 때 대부분 즉각적으로 인지할 수 없다는 것을 의미합니다. DIMM이 정전기 충격을 받았지만, 흔적을 거의 찾아볼 수 없으며, 손상과 관련된 외적인 증상이 즉각적으로 생성되지 않습니다. 몇 주 또는 몇 달이 지나면 흔적이 서서히 사라질 수 있으며 그러한 동안 메모리 무결성, 간헐적인 메모리 오류 등의 성능 저하가 발생할 수 있습니다.

인지하고 문제를 해결하기 어려운 손상 유형은 간헐적으로 발생하는 오류입니다. 이것은 잠복(잠재 또는 "walking wounded") 오류라고도 합니다.

ESD 손상을 방지하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- 접지 처리가 제대로 된 유선 ESD 손목 접지대를 사용하십시오. 무선 정전기 방지 스트랩은 정전기 방지 기능이 충분하지 않기 때문에 더 이상 사용할 수 없습니다. 부품을 처리하기 전에 새시를 건드리면 ESD 손상에 대한 민감도가 증가하여 부품에 적절한 ESD 보호를 제공하지 않습니다.
- 정전기 방지 공간에서 정전기에 민감한 구성 요소를 다룹니다. 가능하다면 정전기 방지 바닥 패드와 작업 패드를 사용하십시오.
- 정전기에 민감한 구성 요소의 포장을 푸는 경우, 부품 설치 준비를 한 후 정전기 방지 포장재에서 제품을 꺼내십시오. 정전기 방지 패키징을 풀려면 먼저 몸에 있는 정전기를 모두 제거해야 합니다.
- 정전기에 민감한 구성 요소를 운반하기 전에 정전기 방지 용기나 포장재에 넣습니다.

ESD 현장 서비스 키트

모니터링되지 않는 현장 서비스 키트가 가장 일반적으로 사용되는 서비스 키트입니다. 각 현장 서비스 키트에는 세 가지 기본 구성 요소인 정전기 방지 매트, 손목 접지대, 본딩 와이어가 포함되어 있습니다.

ESD 현장 서비스 키트의 구성 요소

ESD 현장 서비스 키트의 구성 요소는 다음과 같습니다.

- **정전기 방지 매트** - 정전기 방지 매트는 소산성이며 서비스 절차 중에 부품을 올려 놓을 수 있습니다. 정전기 방지 매트를 사용할 때 손목 접지대의 착용감이 좋아야 하며, 본딩 와이어가 작동 중인 시스템의 매트와 베어 메탈에 연결되어야 합니다. 적절히 배치하면 서비스 부품을 ESD 용기에서 분리하여 매트 위에 직접 놓을 수 있습니다. ESD에 민감한 구성 요소는 손 안, ESD 매트 위, 시스템 내부 또는 용기 안에서 안전합니다.
- **손목 접지대 및 본딩 와이어** - 손목 접지대 및 본딩 와이어는 ESD 매트가 필요하지 않을 경우에 하드웨어에서 손목 접지대와 베어 메탈 간에 직접 연결되거나 매트 위에 일시적으로 놓인 하드웨어를 보호하기 위해 정전기 방지 매트와 연결될 수 있습니다. 피부, ESD 매트 및 하드웨어 간에 손목 접지대와 본딩 와이어의 물리적인 연결을 본딩이라고 합니다. 손목 접지대, 매트, 본딩 와이어가 제공되는 현장 서비스 키트만 사용하십시오. 무선 손목 접지대는 사용하지 마십시오. 손목 접지대의 내부 전선은 일반적인 마모로 인해 손상되기 쉬우며 우발적인 ESD 하드웨어 손상을 방지하기 위해 손목 접지대 테스트를 사용하여 정기적으로 점검해야 합니다. 손목 접지대와 본딩 와이어는 최소 일주일에 한 번 점검하는 것이 좋습니다.
- **ESD 손목 접지대 테스트** - ESD 스트랩 내부의 전선은 시간이 경과하면 손상되기 쉽습니다. 모니터링되지 않는 키트를 사용하는 경우 각 서비스 콜을 이용하기 전에 최소 일주일에 한 번 스트랩을 정기적으로 검사하는 것이 좋습니다. 손목 접지대 테스트는 이러한 테스트를 수행하는 가장 효과적인 방법입니다. 손목 접지대 테스트가 없는 경우 지역 사무소에 재고가 있는지 문의하십시오. 테스트를 수행하려면, 손목 접지대의 본딩 와이어를 테스트에 연결하고 단추를 눌러 테스트를 시작합니다. 녹색 LED가 켜질 경우 테스트가 성공한 것이고, 빨간색 LED가 켜지거나 경고 소리가 나면 테스트에 실패한 것입니다.
- **절연체 요소** - 플라스틱 방열판 케이지 등과 같은 ESD에 민감한 장치는 정전기가 매우 잘 발생하는 절연체인 내부 부품과 멀리 분리해 놓아야 합니다.

- **작업 환경** – ESD 현장 서비스 키트를 배포하기 전에 고객의 입장에서 상황을 평가합니다. 예를 들어 서버 환경용 키트를 배포하는 것은 데스크탑 또는 노트북 환경용 키트를 배포하는 것과 다릅니다. 서버는 일반적으로 데이터 센터 내 랙에, 데스크탑 또는 노트북은 사무실 책상이나 사무 공간 내에 설치됩니다. 복구하려는 시스템 유형을 수용할 수 있는 추가 공간과 함께 ESD 키트를 배포하기에 충분한 작업 영역을 항상 찾아야 합니다. 이러한 작업 영역은 장애물이 없으며 평평하고 개방형 공간이어야 합니다. 또한 ESD를 일으키는 절연체도 없어야 합니다. 작업 영역에서 모든 하드웨어 구성 요소를 실제로 다루기 전에 스티로폼이나 그 외 플라스틱과 같은 절연체와 민감한 부품의 거리를 최소 30cm(12인치) 이상 유지해야 합니다.
- **ESD 포장** – 모든 ESD에 민감한 장치는 정전기 방지 포장으로 배송 및 제공되어야 합니다. 금속 정전기 방지 가방을 사용하는 것이 좋습니다. 그러나 부품이 파손된 경우 항상 새 부품을 받은 것과 동일한 ESD 백 및 포장을 사용하여 해당 부품을 반품해야 합니다. ESD 백을 접은 후 테이프로 밀봉하고 들어 있던 것과 같은 포장 발포제와 함께 새 부품을 받은 원래 상자 안에 넣어야 합니다. ESD에 민감한 장치의 포장은 ESD 방지 작업대에서만 풀어야 하며, 부품을 절대 ESD 백 위에 놓아서는 안 됩니다. 백 안쪽에만 정전기 차폐 처리가 되어 있기 때문입니다. 부품은 항상 손에 잡고 있거나, ESD 매트 위에 놓거나, 시스템 또는 정전기 방지 가방 안에 넣으십시오.
- **민감한 구성 요소 운반** – ESD 민감한 구성 요소(예: 교체 부품 또는 Dell에 반환되는 부품)를 운반할 때는 안전한 운반을 위해 해당 부품을 정전기 방지 가방 안에 넣어야 합니다.

ESD 보호 요약

모든 현장 서비스 기사는 Dell 제품을 수리할 때 항상 기존의 유선 ESD 손목 접지선 및 정전기 방지 매트를 사용하는 것이 좋습니다. 또한 기사는 서비스를 수행하는 동안 민감한 부품을 모든 절연체와 분리시켜 두어야 하며, 민감한 구성 요소를 운반할 때는 정전기 방지 가방을 사용해야 합니다.

민감한 구성요소 운반

교체용 부품이나 Dell에 반품할 부품과 같이 ESD에 민감한 장치를 운반할 때는 정전기 방지 백에 넣어 운반하는 것이 안전합니다.

장비 들어 올리기

무거운 장비를 들어 올릴 때는 다음 지침을 따르십시오.

△ 주의: 50파운드보다 무거운 장비를 들어 올리지 마십시오. 항상 다른 사람에게 도움을 요청하거나 기계 인양 장치를 사용하십시오.

1. 발을 바닥에 안정적으로 딛습니다. 발 사이를 벌려서 안정적인 자세를 취하고 발가락을 바깥쪽으로 향합니다.
2. 배에 힘을 줍니다. 장비를 들어 올릴 때 배의 근육이 허리를 받쳐주어 장비 무게의 균형을 조절할 수 있습니다.
3. 허리가 아닌 다리를 사용하여 들어 올립니다.
4. 장비에 몸을 바짝 붙입니다. 허리 쪽에 가까이 붙일수록 허리에 가해지는 부담이 줄어듭니다.
5. 장비를 들어 올리든 내려 놓든 허리를 바로 세웁니다. 몸의 무게를 장비에 신지 않습니다. 몸과 등을 비틀지 않습니다.
6. 장비를 내릴 때에는 이 지침의 역순을 따르십시오.

컴퓨터 내부 작업을 마친 후에

이 작업 정보

△ 주의: 컴퓨터 내부에 나사가 남아 있거나 느슨한 나사가 존재하는 경우 컴퓨터가 심각하게 손상될 수 있습니다.

단계

1. 나사를 모두 장착하고 컴퓨터 내부에 남아 있는 나사가 없는지 확인합니다.
2. 컴퓨터 작업을 시작하기 전에 분리한 모든 외부 디바이스, 주변 디바이스 및 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.
3. 컴퓨터 작업을 시작하기 전에 분리한 모든 미디어 카드, 디스크 및 기타 부품을 다시 장착합니다.
4. 전원 콘센트에 컴퓨터와 연결된 모든 디바이스를 연결합니다.
5. 컴퓨터를 켭니다.

기술 및 구성 요소

이 장에서는 시스템에서 사용 가능한 기술 및 구성 요소를 자세히 설명합니다.

USB 기능

USB(Universal Serial Bus)라고 불리는 범용 직렬 버스는 1996년에 도입되었습니다. USB는 호스트 컴퓨터와 마우스, 키보드, 외부 드라이브, 프린터와 같은 주변 기기 간의 연결을 획기적으로 단순화시켰습니다.

표 1. USB 진화

유형	데이터 전송률	범주	도입 년도
USB 2.0	480Mbps	고속	2000
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 포트	5Gbps	SuperSpeed	2010
USB 3.1 Gen2	10Gbps	SuperSpeed	2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1(SuperSpeed USB)

지난 몇 년간 USB 2.0은 약 60억 개가 판매되면서 사실상 PC 업계의 인터페이스 표준으로 확고한 지위를 다졌지만, 그 어느 때보다도 신속한 전산 하드웨어와 큰 대역폭 요구로 인해 더욱 빠른 성장에 대한 필요성이 대두되고 있습니다. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1은 마침내 이전 모델보다 (이론적으로) 10배 빠른 속도로 고객의 요구에 부응하게 되었습니다. 간단히 말해, USB 3.1 Gen 1의 기능은 다음과 같습니다.

- 증대된 전송 속도(최대 5 Gbps)
- 전력 소모량이 높은 디바이스를 위한 최대 버스 전력 및 기기 전류 증가
- 새 전원 관리 기능
- 전체 이중 데이터 전송 및 신규 전송 유형 지원
- 이전 버전 USB 2.0 호환 가능
- 새 커넥터 및 케이블

아래에 USB 3.0/USB 3.1 Gen 1에 관해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변이 포함되어 있습니다.

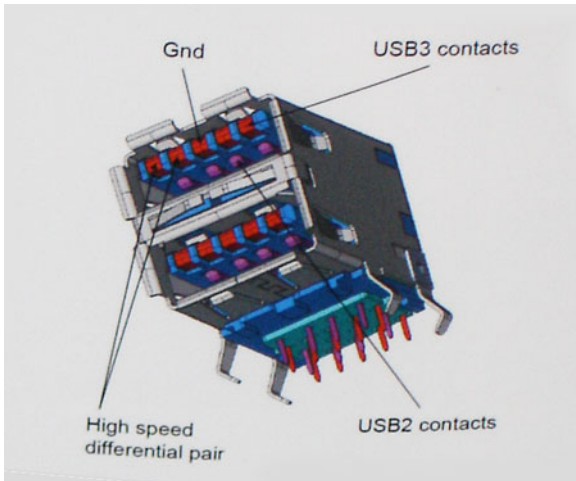


속도

현재 최신 USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 사양으로 정의되는 3가지 속도 모드가 있습니다. 이러한 속도 모드는 SuperSpeed, Hi-Speed, Full-Speed입니다. 새로운 SuperSpeed 모드의 전송 속도는 4.8Gbps입니다. 사양은 보통 각각 USB 2.0 및 1.1로 알려진 Hi-Speed 및 Full-Speed USB 모드이지만, 좀 더 낮은 속도의 모드는 각각 480Mbps 및 12Mbps에서 작동하고 이전 버전과의 호환성을 유지합니다.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1은 다음과 같은 기술적 변경 사항을 적용해 훨씬 뛰어난 성능을 제공합니다.

- 기존 USB 2.0 버스(아래의 이미지 참조)와 병렬로 물리적 버스가 추가되었습니다.
- 이전의 USB 2.0에는 4개의 와이어(전원, 접지, 차등 데이터용 1쌍)가 있었으나, USB 3.0/USB 3.1 Gen 1의 경우 커넥터 및 케이블 연결에 총 8개의 결합된 커넥션을 위해 4개가 추가된 2쌍의 차등 신호(수신 및 전송)가 설치되어 있습니다.
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1은 USB 2.0의 반이중 배열이 아닌 양방향 데이터 인터페이스를 활용합니다. 이론상으로는 대역폭이 10배 늘어납니다.



오늘날 고화질 비디오 콘텐츠의 데이터 전송, 테라바이트 스토리지 디바이스, 고등급 메가픽셀 디지털 카메라 등에 대한 기대가 점점 높아짐에 따라, USB 2.0의 속도는 충분하지 않을 수 있습니다. 게다가 USB 2.0을 연결해도 데이터 전송은 실제 최대 데이터 전송 속도인 320Mbps(40MB/s) 정도로, 이론상 최대 처리량인 480Mbps에 결코 근접할 수 없습니다. 마찬가지로 USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 연결 역시 4.8Gbps에 도달할 수 없습니다. 현실적인 최대 전송 속도는 최대 400MB/s로 볼 수 있을 것입니다. 이 속도에서 USB 3.0/USB 3.1 Gen 1의 성능은 USB 2.0보다 10배 향상됩니다.

응용 프로그램

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1은 좁은 공간을 확장하고, 디바이스에 대해 더 많은 가용 공간을 제공하여 전반적인 사용 경험을 향상시킵니다. 그동안 USB 비디오의 화질이 최대 해상도, 지연, 비디오 압축 면에서 매우 좋지 않았던 점을 감안할 때, 대역폭이 5~10배 좋아질 경우 USB 비디오 솔루션이 크게 향상될 것이라는 것을 쉽게 예상할 수 있습니다. 단일 링크 DVI에서는 대략 2Gbps의 처리량이 필요합니다. 이때 480Mbps에 한계가 있을 경우, 5Gbps는 기대 이상으로 발전 가능성이 높습니다. 4.8Gbps가 보장된다면 표준은 외부 RAID 스토리지 시스템처럼 USB 영역에 속하지 않았던 일부 제품에서 답을 찾을 것입니다.

SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1을 사용할 수 있는 제품은 다음과 같습니다.

- 외장형 USB 3.0 데스크탑/ USB 3.1 Gen 1 하드 드라이브
- 휴대용 USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 하드 드라이브
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 드라이브 도크 및 어댑터
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 플래시 드라이브 및 판독기
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 솔리드 스테이트 드라이브
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 RAID
- 광학 매체 드라이브
- 멀티미디어 디바이스
- 네트워킹
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 어댑터 카드 및 허브

호환성

다행히 USB 3.0/USB 3.1 Gen 1은 처음부터 USB 2.0과 정상적으로 호환되도록 면밀하게 계획되었습니다. 무엇보다도, USB 3.0/USB 3.1 Gen 1은 새로운 물리적 연결을 지정함에 따라 새로운 프로토콜의 더 빠른 성능을 활용하는 새 케이블을 지정하면서, 커넥터 자체는 전과 정확히 동일한 위치에 4개의 USB 2.0 접촉부가 있는 동일한 직사각형 모양을 유지하고 있습니다. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1에는 독립적으로 데이터를 수신 및 전송하는 5개의 새로운 연결부가 있으며, 적절한 SuperSpeed USB 연결부에 연결할 때에만 작동됩니다.

USB Type-C

USB Type-C는 새로운 소형 물리적 커넥터입니다. 커넥터 자체에 USB 3.1 및 USB PD(USB Power Delivery)와 같은 다양한 신규 USB 표준 지원 기능이 있습니다.

대체 모드

USB Type-C는 새로운 초소형 커넥터 표준으로, 이전 USB Type-A 플러그의 약 1/3 크기입니다. 이는 모든 디바이스에서 사용할 수 있는 단일 커넥터 표준입니다. USB Type-C 포트는 "대체 모드"를 사용하여 다양한 프로토콜을 지원할 수 있으므로 이를 통해 해당 단일 USB 포트에서 HDMI, VGA, DisplayPort 또는 다른 유형의 연결 출력이 가능한 어댑터를 확보할 수 있습니다.

USB Power Delivery

USB PD 사양은 USB Type-C와도 밀접히 연결되어 있습니다. 현재 스마트폰, 태블릿 및 기타 모바일 디바이스는 대체로 USB 연결을 사용하여 충전합니다. USB 2.0 연결은 최대 2.5W의 전력을 제공하지만, 이 정도로는 휴대폰 충전밖에 할 수 없습니다. 예를 들어, 노트북 컴퓨터는 최대 60W가 필요합니다. USB Power Delivery 사양은 이 전원 전달 성능을 최대 100W까지 높여줍니다. 양방향이므로 디바이스는 전력 송수신이 모두 가능합니다. 또한 디바이스가 연결을 통해 데이터를 전송함과 동시에 전력을 수신할 수 있습니다.

이는 모든 충전이 표준 USB 연결로 가능해져서 더 이상 개인 노트북 컴퓨터 충전 케이블이 필요하지 않습니다. 스마트폰 충전을 위한 휴대용 배터리 팩 및 다른 최신 휴대용 디바이스로 노트북 컴퓨터를 충전할 수 있습니다. 노트북 컴퓨터를 전원 케이블에 연결된 외장 디스플레이에 연결하면 외장 디스플레이를 사용하면서 노트북 컴퓨터 충전까지 동시에 할 수 있습니다. 이 모든 것이 하나의 작은 USB Type-C 연결로 가능합니다. 이를 사용하려면 디바이스 및 케이블이 USB Power Delivery를 지원해야 하므로 USB Type-C 연결이 있다고 해서 항상 지원되는 것은 아닙니다.

USB Type-C 및 USB 3.1

USB 3.1은 새로운 USB 표준입니다. USB 3의 이론상 대역폭은 5Gbps지만, USB 3.1은 그 두 배인 10Gbps의 이론상 대역폭을 제공하며 1세대 Thunderbolt 커넥터만큼 빠른 속도를 자랑합니다. USB Type-C는 USB 3.1과는 다릅니다. USB Type-C는 커넥터의 모양일 뿐, 기반 기술은 USB 2 또는 USB 3.0일 수 있습니다. 실제로, Nokia의 N1 Android 태블릿은 USB Type-C 커넥터를 사용하지만 기반은 USB 3.0이 아닌 모두 USB 2.0입니다. 그러나 이러한 기술은 서로 밀접하게 관련되어 있습니다.

USB Type-C 사용 Thunderbolt

Thunderbolt는 한 번의 연결로 데이터, 비디오, 오디오 및 전원을 결합하는 하드웨어 인터페이스입니다. Thunderbolt는 PCI Express(PCIe) 및 DisplayPort(DP)를 하나의 직렬 신호로 결합하고 추가적으로 DC 전원, 올인원 케이블을 제공합니다. Thunderbolt 1 및 Thunderbolt 2는 miniDP(DisplayPort)와 같은 커넥터를 사용하는 반면 Thunderbolt 3은 USB Type-C 커넥터를 사용하여 주변 장치와 연결합니다.

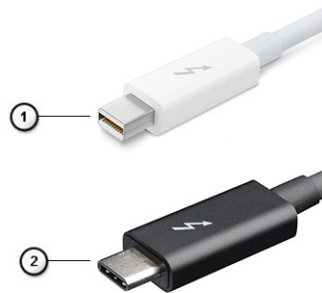


그림 1. Thunderbolt 1 및 Thunderbolt 3

1. Thunderbolt 1 및 Thunderbolt 2(miniDP 커넥터 사용)
2. Thunderbolt 3(USB Type-C 커넥터 사용)

USB Type-C 사용 Thunderbolt 3

Thunderbolt 3은 최대 속도 40Gbps를 자랑하는 USB Type-C를 지원하여, 모든 일을 처리할 수 있는 하나의 컴팩트한 포트로서 Thunderbolt를 향상시켰습니다. 이를 통해 모든 도킹, 디스플레이 또는 외장 하드 드라이브 같은 데이터 장치와 가장 빠르고 다양한 방법의 연결을 제공합니다. Thunderbolt 3은 USB Type-C 커넥터/포트를 사용하여 지원되는 주변 장치와 연결됩니다.

1. Thunderbolt 3은 USB Type-C 커넥터와 케이블을 사용하므로 휴대성이 좋고 방향 전환이 가능합니다.
2. Thunderbolt 3은 최대 40Gbps 속도를 제공합니다.

3. DisplayPort 1.4 - 기존 DisplayPort 모니터, 장치 및 케이블과 호환
4. USB Power Delivery - 지원되는 컴퓨터에서 최대 130W

USB Type-C 사용 Thunderbolt 3의 주요 기능

1. Thunderbolt, USB, DisplayPort 및 USB Type-C의 전원을 하나의 케이블로 정리(제품에 따라 제공되는 기능이 다를 수 있음)
2. 휴대성이 좋고 복구하기 쉬운 USB Type-C 커넥터와 케이블
3. Thunderbolt 네트워킹 지원(*제품에 따라 다를 수 있음)
4. 최대 4K 디스플레이 지원
5. 최대 40Gbps

이 노트: 데이터 전송 속도는 장치마다 다를 수 있습니다.

Thunderbolt 아이콘



Protocol	USB Type-A	USB Type-C	Notes
Thunderbolt	Not Applicable		Will use industry standard icon regardless of port style (i.e., mDP or USB Type-C)
Thunderbolt w/ Power Delivery	Not Applicable		Up to 130 Watts via USB Type-C

그림 2. Thunderbolt 아이콘 변동

HDMI 1.4a

본 주제는 HDMI 1.4a 및 기능과 그에 따른 이점을 설명합니다.

HDMI(고선명 멀티미디어 인터페이스)는 산업 기반, 비압축 방식의 전체 디지털 음향/영상 인터페이스입니다. HDMI는 호환 디지털 음향/영상 기기(DVD 플레이어, A/V 수신기 등)와 호환 디지털 음향/영상 모니터(디지털 TV(DTV) 등) 간 인터페이스를 제공합니다. 눈에 띄는 점은 케이블 수 감소와 콘텐츠 보호 기능입니다. HDMI는 하나의 케이블로 표준, 향상된 고화질 영상과 다채널 디지털 음향을 동시에 전달합니다.

HDMI 1.4a 기능

- **HDMI 이더넷 채널** - HDMI 링크에 고속 네트워크를 추가하여 별도의 이더넷 케이블 없이도 사용자가 IP 활성화 디바이스를 활용할 수 있게 합니다.
- **오디오 리턴 채널** - 내장형 튜너가 포함되어 있고 HDMI가 연결된 TV가 별도의 오디오 케이블 없이 서라운드 오디오 시스템으로 오디오 데이터 '업스트림'을 전송할 수 있습니다.
- **3D** - 3D 게임 및 홈시어터 애플리케이션을 위한 주요 3D 비디오 형식의 입출력 프로토콜을 지정합니다.
- **콘텐츠 유형** - 콘텐츠에 따라 TV가 화질 설정을 최적화할 수 있도록 디스플레이 및 소스 디바이스 간의 콘텐츠 유형을 실시간으로 신호 교환합니다.
- **추가 색상 영역** - 디지털 사진 또는 컴퓨터 그래픽에서 사용된 추가 색상 모델 지원을 추가합니다.
- **4K 지원** - 많은 상업 영화관에서 사용하는 디지털 시네마 시스템에서 사용되는 차세대 디스플레이를 위한 1080p 이상의 비디오 해상도를 활성화합니다.
- **HDMI 마이크로 커넥터** - 최대 1080p의 비디오 해상도를 지원하는 휴대전화 및 기타 이동식 디바이스를 위한 신규 소형 커넥터입니다.
- **자동차 연결 시스템** - 자동차 비디오 시스템을 위한 신규 케이블 및 커넥터로 진정한 고품질의 해상도를 제공하며 자동차 환경에 적합하게 설계되었습니다.

HDMI 이점

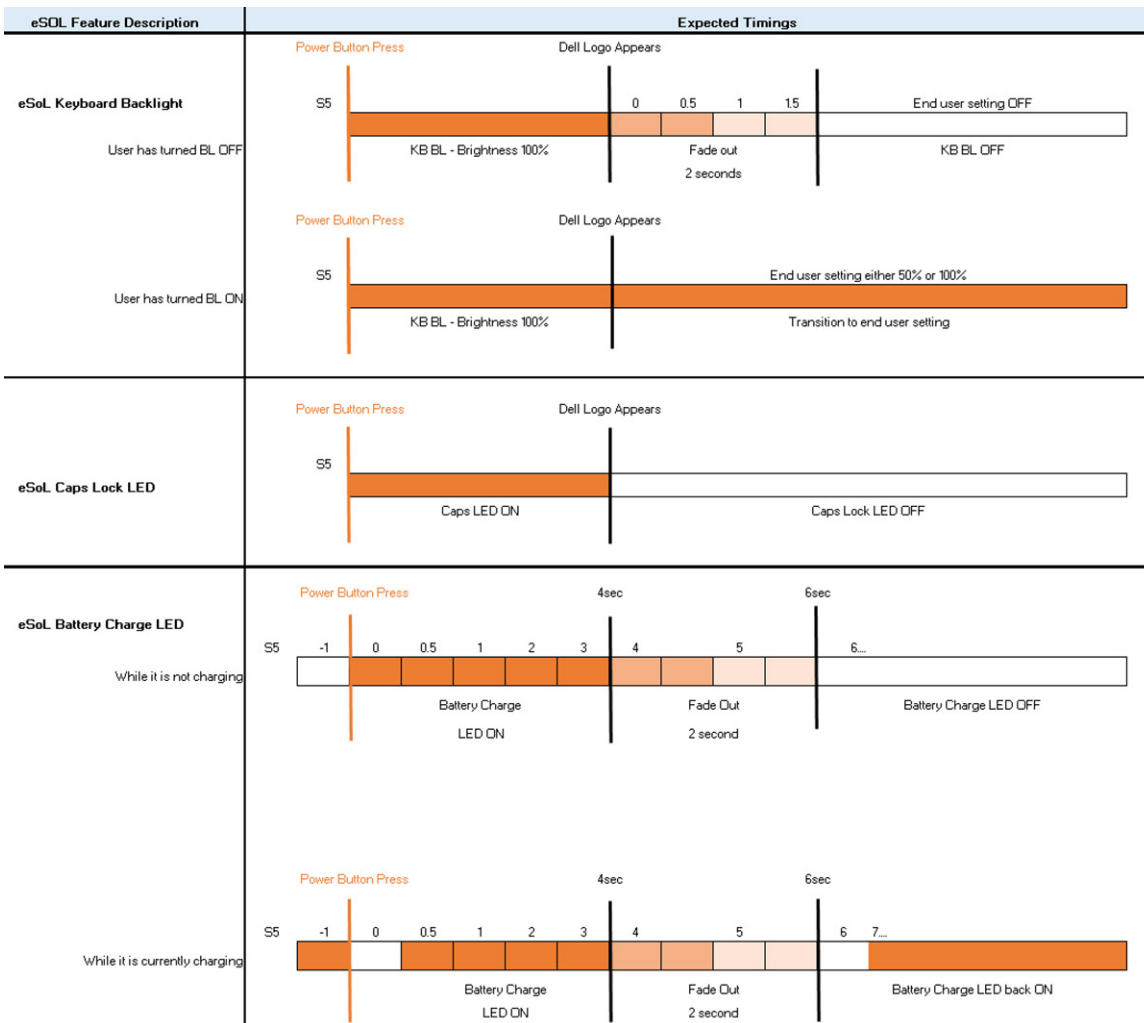
- 품질 HDMI는 선명한 화질을 위해 비압축된 디지털 오디오 및 비디오를 전송합니다.
- 저비용 HDMI는 단순하고 경제적인 방식으로 비압축된 비디오 형식을 지원하는 동시에 디지털 인터페이스의 품질과 기능을 제공합니다.
- 오디오 HDMI는 표준 스테레오부터 멀티채널 서라운드 사운드까지, 다양한 오디오 형식을 지원합니다.

- HDMI는 비디오와 멀티채널 오디오를 하나의 케이블로 통합하여 현재 A/V 시스템에서 사용되는 많은 케이블로 인해 발생하는 비용과 복잡성을 줄여줍니다.
- HDMI는 비디오 소스(예: DVD 플레이어)와 DTV 간의 통신을 지원하므로 새 기능을 사용할 수 있습니다.

지문 인식기가 있는 전원 켜기 및 LED 동작

지문 인식기가 있는 전원 켜기 및 LED 동작

- 전원 버튼을 50밀리초~2초 동안 누르면 디바이스가 켜집니다.
- 전원 버튼은 SOL(Sign-Of-Life)이 사용자에게 제공될 때까지 추가적인 누르기를 등록하지 않습니다.
- 전원 버튼을 누르면 시스템 LED가 켜집니다.
- 모든 사용 가능한 LED(키보드 백라이트/키보드Caps Lock LED/배터리 충전 LED)가 켜지고 지정된 동작을 표시합니다.
- 청각 음은 기본값으로 꺼짐 상태입니다. 이는 BIOS 설정에서 활성화할 수 있습니다.
- 보호 기능은 디바이스가 로그인 프로세스에서 정지되어도 타임아웃되지 않습니다.
- Dell 로고: 전원 버튼을 누른 후 2초 내로 켜집니다.
- 전체 부팅: 전원 버튼을 누른 후 22초 내로 수행됩니다.
- 아래는 일정 예시입니다.



지문 인식기가 탑재된 전원 버튼은 LED가 없으며 시스템 안에서 사용할 수 있는 LED를 활용하여 시스템 상태를 표시합니다.

- **전원 어댑터 LED:**
 - 전기 콘센트에서 전원이 공급되면 전원 어댑터 커넥터의 LED가 흰색으로 켜집니다.
- **배터리 상태 LED:**
 - 컴퓨터가 전기 콘센트에 연결되어 있는 경우, 배터리 표시등은 다음과 같이 동작합니다.
 1. 솔리드 화이트 - 배터리를 충전하는 중입니다. 충전이 완료되면 LED가 꺼집니다.

- 컴퓨터가 배터리로 작동하는 중에는 배터리 표시등이 다음과 같이 동작합니다.
 1. 꺼짐 - 배터리가 충분히 충전되었습니다(또는 컴퓨터가 꺼진 상태입니다).
 2. 주황색으로 고정 - 배터리 잔량이 매우 부족합니다. 배터리 부족 상태는 남은 배터리 지속 시간이 대략 30분 이하임을 나타냅니다.

- **카메라 LED**

- 카메라가 켜지면 흰색 LED가 활성화됩니다.

- **마이크 음소거 LED:**

- 활성화 시(음소거) <F4> 키의 마이크 음소거 LED가 흰색으로 켜져야 합니다.

- **RJ45 LED:**

- **표 2. RJ45 포트 양쪽의 LED**

링크 속도 표시등(LHS)	작동 표시등(RHS)
녹색	주황색

분해 및 재조립

베이스 덮개

베이스 커버 제거

전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.

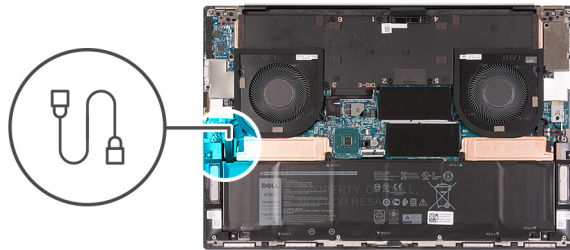
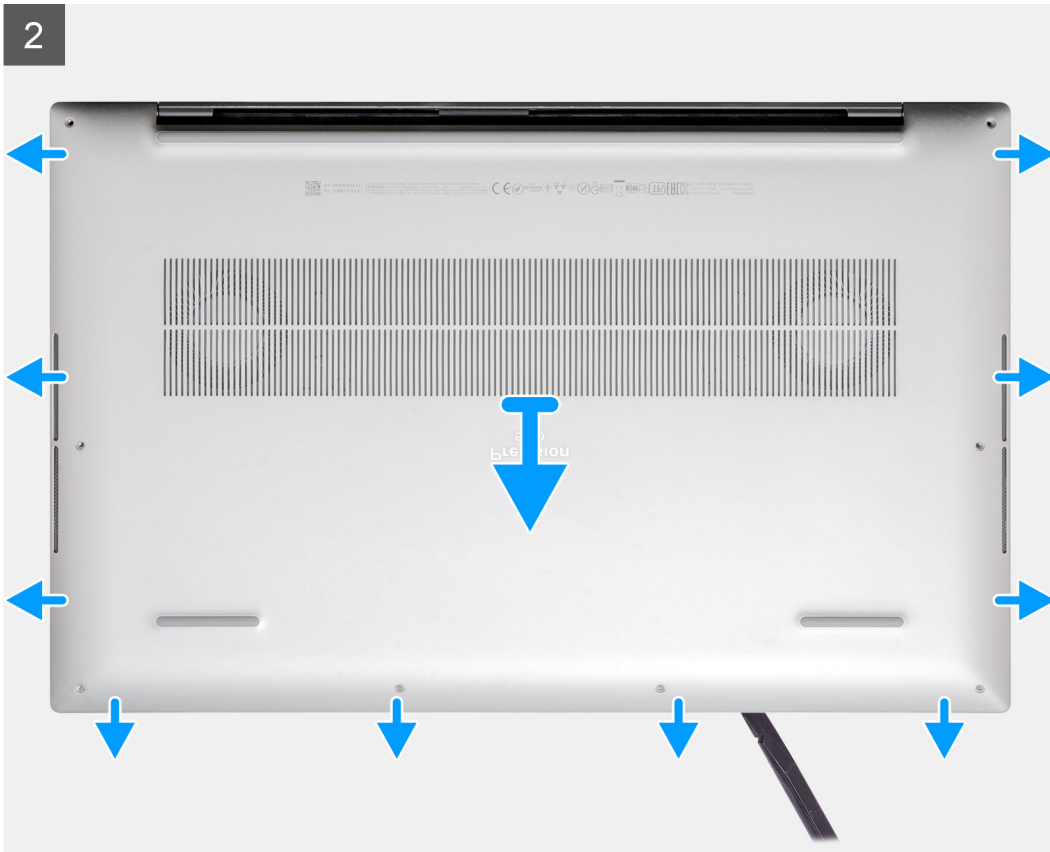
이 작업 정보

다음 이미지는 베이스 커버의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



8x
M2.5x4





단계

1. 베이스 커버를 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 8개의 M2.5x4 나사를 제거합니다.
2. 플라스틱 스크라이버를 사용하여 손목 받침대 및 키보드 어셈블리에서 베이스 커버를 들어 올립니다.

△ 주의: 베이스 커버가 손상될 수 있으므로 힌지가 위치한 측면에서 베이스 커버를 잡아당기거나 들어 올리지 마십시오.

- ① **노트:** 오디오 보드 접지용 베이스 커버 하단 핀은 손상되기 쉽습니다. 핀의 손상을 방지하기 위해 베이스 커버를 깨끗한 표면에 놓습니다.
- ① **노트:** 다음 단계는 컴퓨터에서 기타 구성 요소를 추가로 제거하려는 경우에만 적용됩니다.
- ① **노트:** 배터리 케이블을 연결 해제하거나 배터리를 제거하면 컴퓨터의 BIOS 설정이 재설정됩니다.

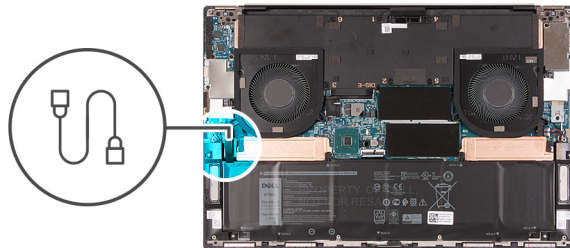
3. 시스템 보드에서 배터리 케이블을 분리합니다.

베이스 커버 설치

전제조건

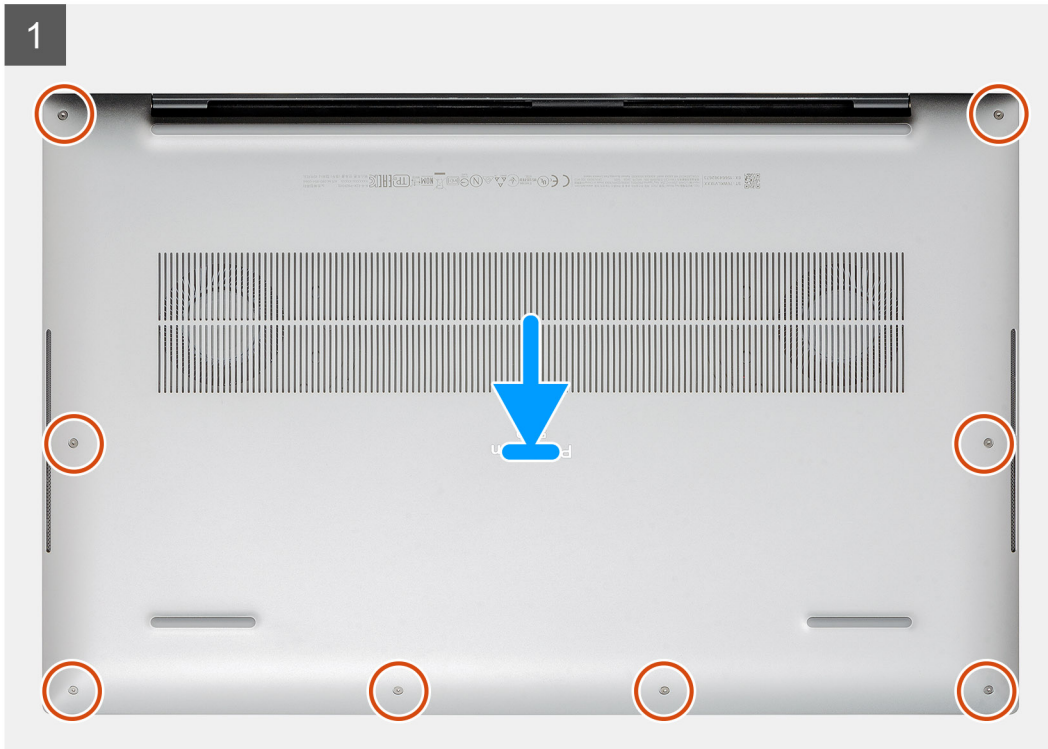
이 작업 정보

다음 이미지는 베이스 커버의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여 줍니다.





8x
M2.5x4



단계

1. 해당하는 경우, 배터리 케이블을 시스템 보드에 연결합니다.
2. 베이스 커버의 나사 구멍을 손목 받침대 및 키보드 어셈블리의 나사 구멍에 맞춘 다음 베이스 커버를 제자리에 끼웁니다.
3. 베이스 커버를 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 8개의 M2.5x4 나사를 장착합니다.

다음 단계

1. [컴퓨터 내부 작업을 마친 후에](#)의 절차를 따릅니다.

배터리

배터리 제거

전제조건

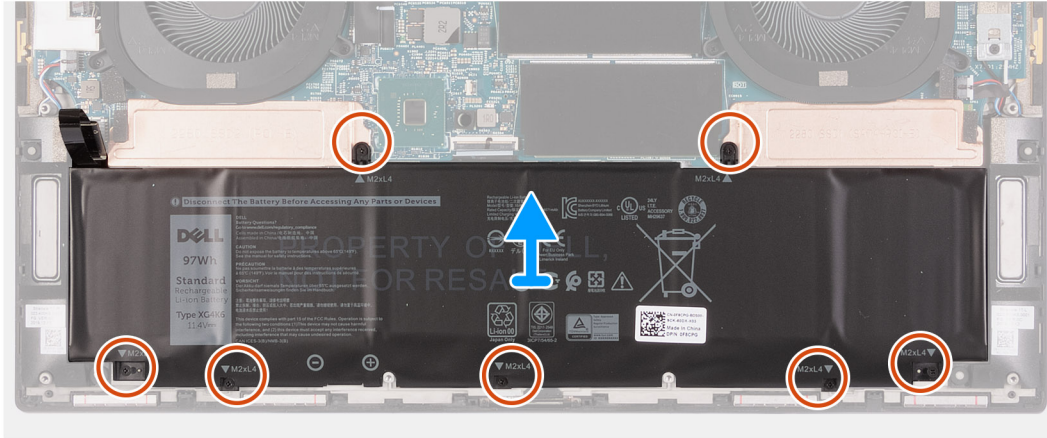
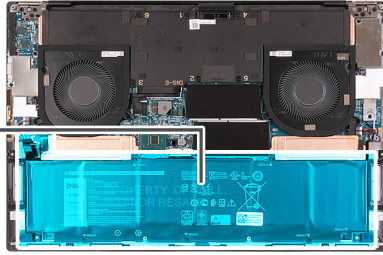
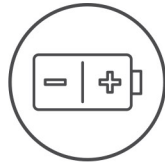
1. [컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에](#)의 절차를 따릅니다.
2. 베이스 커버를 제거합니다.
 - ① **노트:** 배터리를 제거하면 CMOS가 지워지며 컴퓨터의 BIOS 설정이 재설정됩니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 배터리의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



7x
M2x4



단계

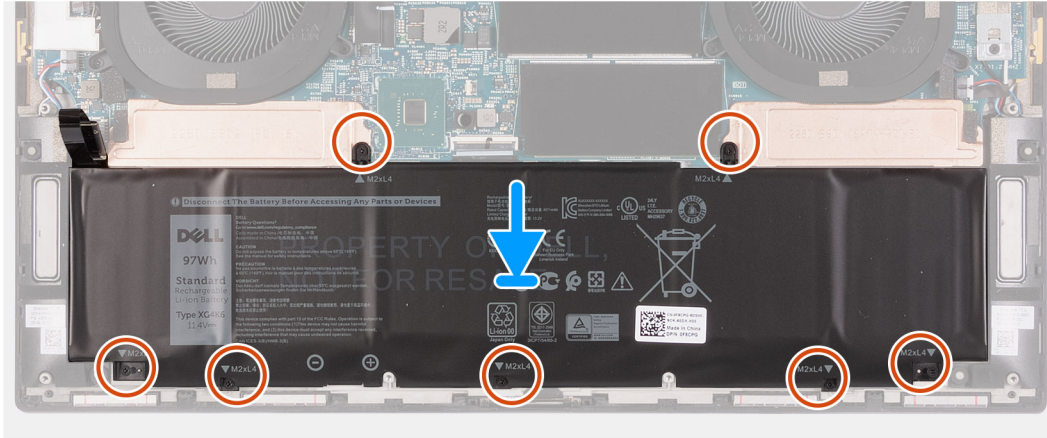
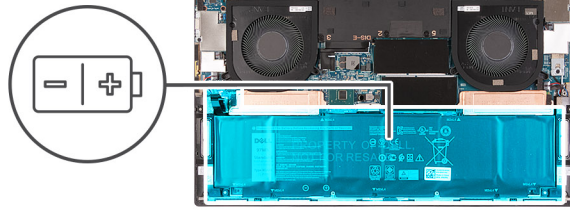
1. 이전에 연결 해제하지 않은 경우 배터리 케이블을 시스템 보드에서 연결 해제합니다.
2. 솔리드 스테이트 드라이브 열 브래킷과 배터리를 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 7개의 나사(M2x4)를 제거합니다.
 ⓘ **노트:** 배터리의 상단을 고정하는 2개의 나사(M2x4)는 솔리드 스테이트 드라이브 열 브래킷도 시스템 보드에 고정합니다.
3. 배터리를 들어 올려 팜레스트 및 키보드 어셈블리에서 분리합니다.

배터리 설치

전제조건

이 작업 정보

다음 이미지는 배터리의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



단계

1. 각 솔리드 스테이트 드라이브 열 브래킷의 나사 구멍을 팜레스트 및 키보드 어셈블리의 해당 나사 구멍에 맞춥니다.
2. 배터리의 나사 구멍을 팜레스트 및 키보드 어셈블리와 솔리드 스테이트 열 브래킷의 나사 구멍에 맞춥니다.
이 노트: 배터리의 상단을 고정하는 2개의 나사(M2x4)는 솔리드 스테이트 드라이브 열 브래킷도 시스템 보드에 고정합니다. 솔리드 스테이트 드라이브 열 브래킷이 배터리와 시스템 보드 사이에 설치되었는지 확인합니다.
3. 배터리 상단과 솔리드 스테이트 드라이브 열 브래킷을 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 2개의 나사(M2x4)를 장착합니다.
4. 배터리의 하단을 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 5개의 나사(M2x4)를 장착합니다.
5. 배터리 케이블을 시스템 보드에 연결합니다.

다음 단계

1. 베이스 커버를 설치합니다.
2. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

메모리 모듈

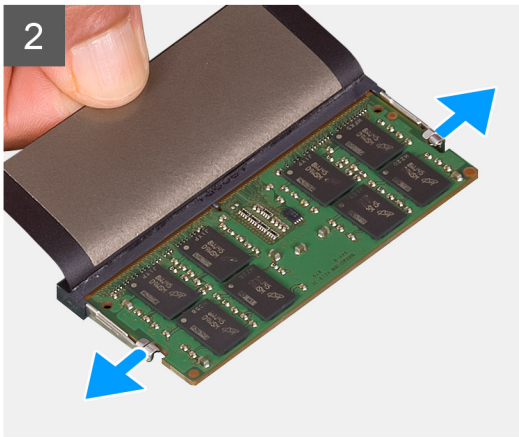
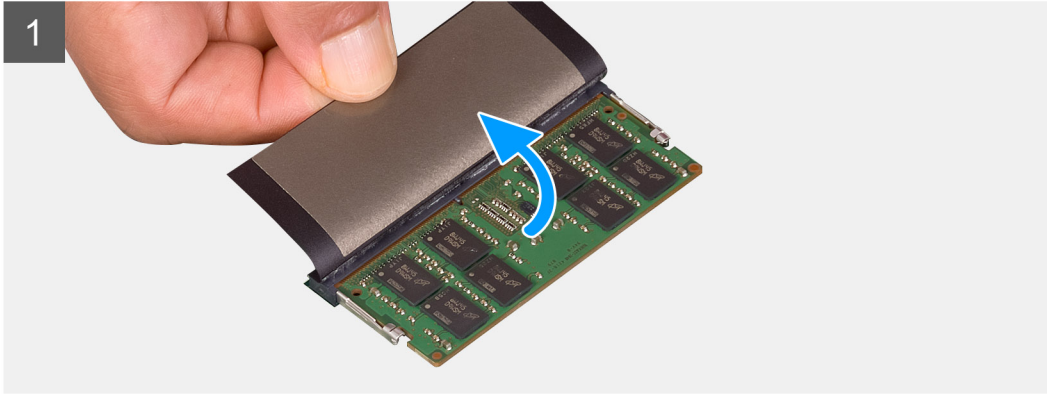
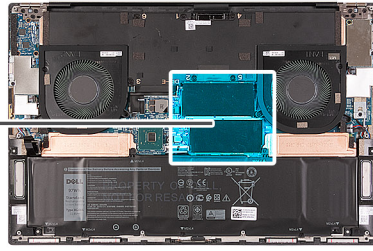
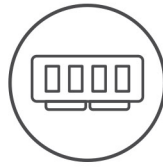
메모리 모듈 제거

전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 베이스 커버를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 그림은 메모리 모듈의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

1. 메모리 모듈을 덮은 플랩을 들어 올립니다.
2. 메모리 모듈이 튀어 나올 때까지 메모리 모듈 슬롯의 양쪽 끝에 있는 고정 클립을 손끝으로 조심스럽게 벌립니다.
3. 메모리 모듈을 밀어 메모리 모듈 슬롯에서 분리합니다.

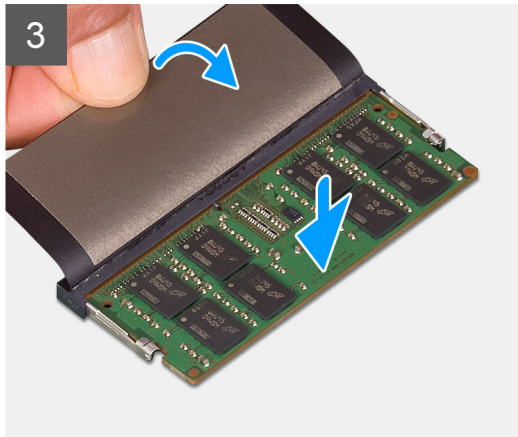
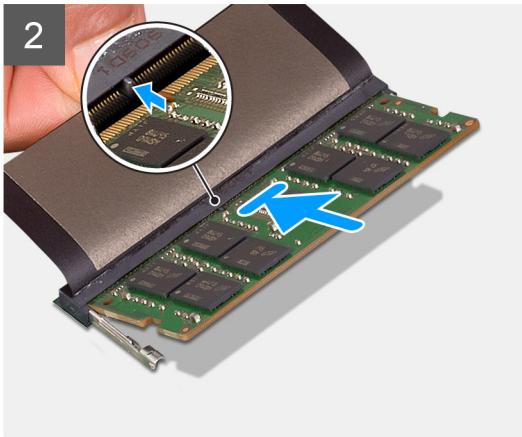
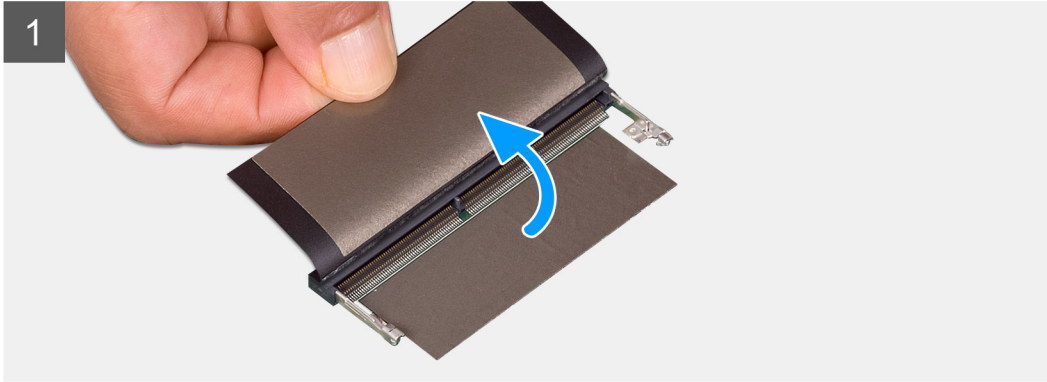
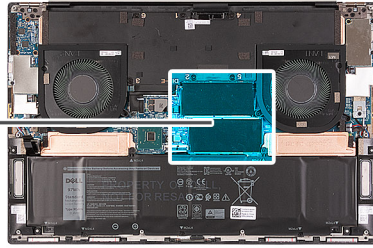
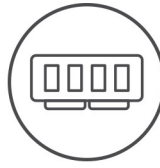
이 | **노트:** 제거할 다른 메모리 모듈이 있는 경우 1단계와 2단계를 반복합니다.

메모리 모듈 설치

전제조건

이 작업 정보

다음 이미지는 메모리 모듈의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



단계

1. 메모리 모듈 슬롯을 덮은 플랩을 들어 올립니다.
2. 메모리 모듈의 노치를 메모리 모듈 슬롯의 탭에 맞춥니다.
3. 메모리 모듈을 일정한 각도로 메모리 모듈 슬롯에 단단히 밀어 넣습니다.
4. 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 메모리 모듈을 아래로 누릅니다.

① 노트: 소리가 나지 않으면 메모리 모듈을 제거했다가 다시 설치합니다.

① 노트: 설치할 다른 메모리 모듈이 있는 경우 1단계~4단계를 반복합니다.

다음 단계

1. 베이스 커버를 설치합니다.
2. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

SSD1 슬롯의 솔리드 스테이트 드라이브

SSD1 슬롯에서 M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 제거

전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 베이스 커버를 제거합니다.
3. 배터리를 제거합니다.

이 작업 정보

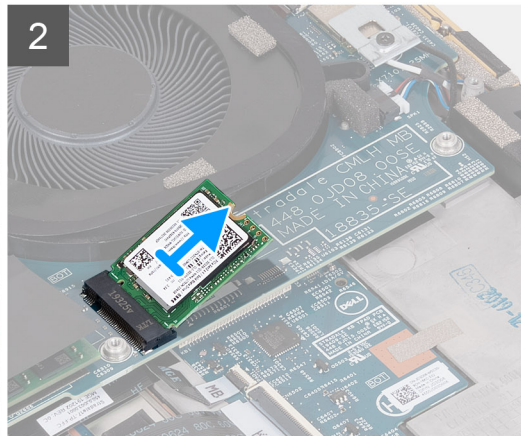
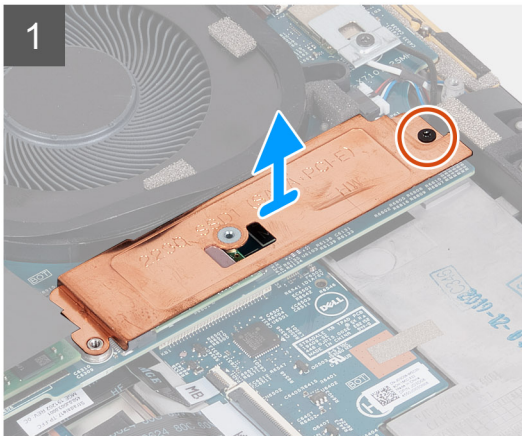
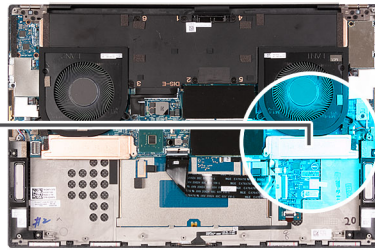
이 노트: 이 절차는 SSD1 슬롯에 M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브가 설치된 컴퓨터에만 적용됩니다.

이 노트: 주문한 구성에 따라 컴퓨터는 SSD1 슬롯에서 M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 또는 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브를 지원할 수 있습니다.

다음 이미지는 SSD1 슬롯에 설치된 M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



1x
M2x4



단계

1. 솔리드 스테이트 드라이브 열 브래킷과 솔리드 스테이트 드라이브를 시스템 보드에 고정하는 M2x4 나사를 제거합니다.
2. 열판을 들어 올려 시스템 보드에서 분리합니다.
3. 솔리드 스테이트 드라이브를 밀어 SSD1 슬롯에서 들어냅니다.

SSD1 슬롯에 M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

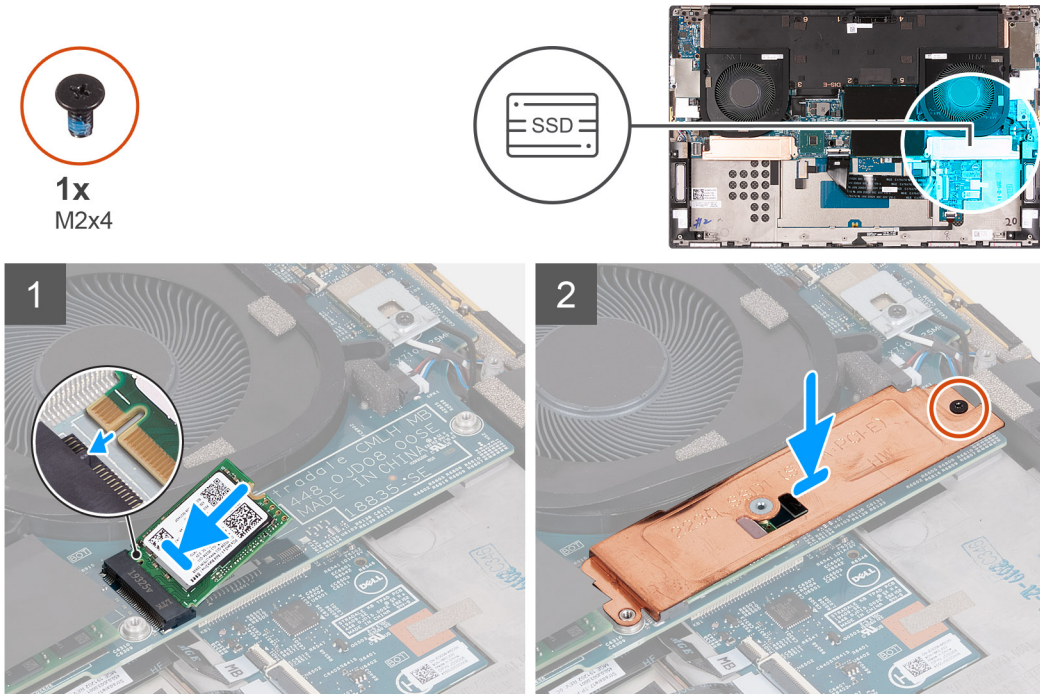
이 작업 정보

이 노트: 이 절차는 SSD1 슬롯에 M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브가 설치된 컴퓨터에만 적용됩니다.

① **노트:** 주문한 구성에 따라 컴퓨터는 SSD1 슬롯에서 M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 또는 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브를 지원할 수 있습니다.

① **노트:** 솔리드 스테이트 드라이브 마운팅 브래킷이 설치되어 있지 않으면 설치합니다.

다음 이미지는 SSD1 슬롯에 설치된 M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

1. 솔리드 스테이트 드라이브의 노치를 SSD1 슬롯의 탭에 맞춥니다.
2. 솔리드 스테이트 드라이브를 SSD1 슬롯에 밀어 넣습니다.
3. 가이드 포스트를 사용하여 솔리드 스테이트 열 브래킷을 솔리드 스테이트 드라이브 위에 놓습니다.
4. 솔리드 스테이트 열 브래킷의 나사 구멍을 시스템 보드의 나사 구멍에 맞춥니다.
5. 솔리드 스테이트 열 브래킷과 솔리드 스테이트 드라이브를 시스템 보드에 고정하는 M2x4 나사를 장착합니다.

다음 단계

1. **베이스 커버**를 설치합니다.
2. **배터리**를 설치합니다.
3. **컴퓨터 내부 작업을 마친 후**의 절차를 따릅니다.

SSD1 슬롯에서 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브 제거

전제조건

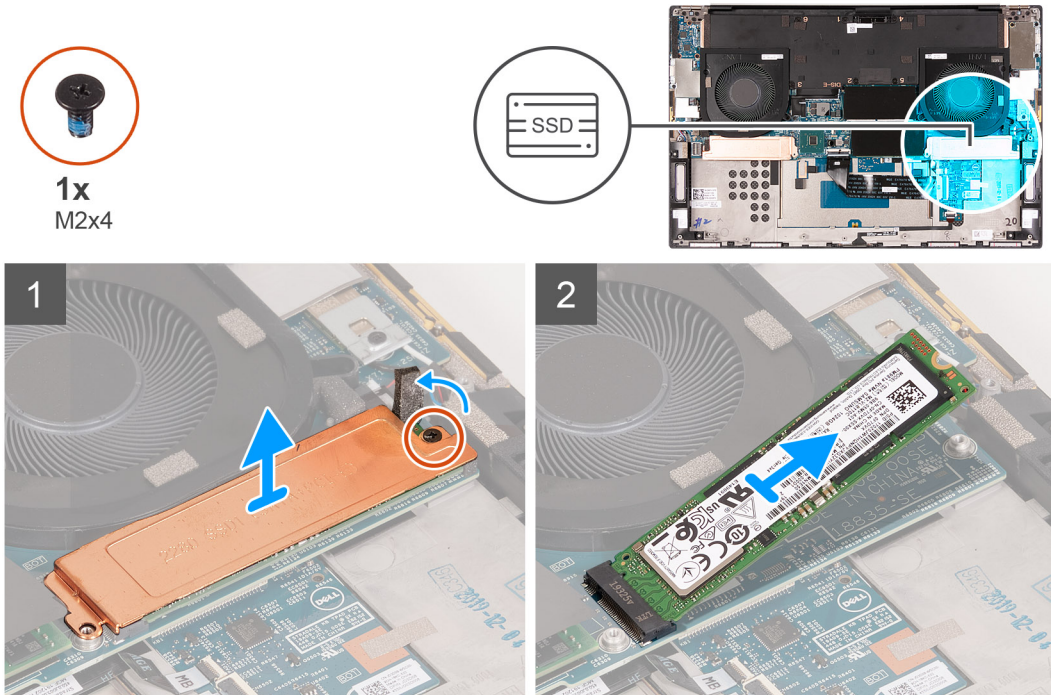
1. **컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전**의 절차를 따릅니다.
2. **베이스 커버**를 제거합니다.
3. **배터리**를 제거합니다.

이 작업 정보

① **노트:** 이 절차는 SSD1 슬롯에 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브가 설치된 컴퓨터에만 적용됩니다.

① **노트:** 주문한 구성에 따라 컴퓨터는 SSD1 슬롯에서 M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 또는 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브를 지원할 수 있습니다.

다음 이미지는 SSD1 슬롯에 설치된 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

1. 솔리드 스테이트 드라이브 열 브래킷과 솔리드 스테이트 드라이브를 시스템 보드에 고정하는 M2x4 나사를 제거합니다.
2. 열판을 들어 올려 시스템 보드에서 분리합니다.
3. 솔리드 스테이트 드라이브를 밀어 SSD1 슬롯에서 들어냅니다.

SSD1 슬롯에 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

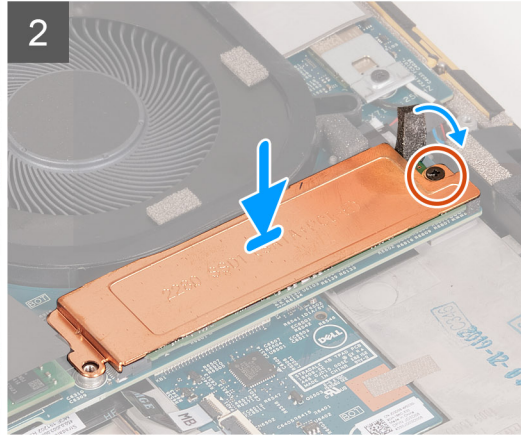
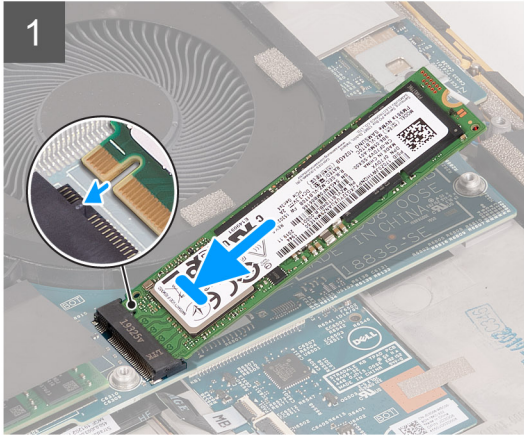
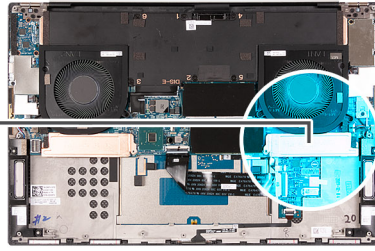
이 작업 정보

- ① **노트:** 이 절차는 SSD1 슬롯에 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브가 설치된 컴퓨터에만 적용됩니다.
- ① **노트:** 주문한 구성에 따라 컴퓨터는 SSD1 슬롯에서 M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 또는 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브를 지원할 수 있습니다.
- ① **노트:** 솔리드 스테이트 드라이브 마운팅 브래킷이 설치되어 있지 않으면 설치합니다.

다음 이미지는 SSD1 슬롯에 설치된 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



1x
M2x4



단계

1. 솔리드 스테이트 드라이브의 노치를 SSD1 슬롯의 탭에 맞춥니다.
2. 솔리드 스테이트 드라이브를 SSD1 슬롯에 밀어 넣습니다.
3. 가이드 포스트를 사용하여 솔리드 스테이트 드라이브 열 브래킷을 솔리드 스테이트 드라이브 위에 놓습니다.
4. 솔리드 스테이트 드라이브 열 브래킷의 나사 구멍을 시스템 보드의 나사 구멍에 맞춥니다.
5. 솔리드 스테이트 드라이브 열 브래킷과 솔리드 스테이트 드라이브를 시스템 보드에 고정하는 M2x4 나사를 장착합니다.

다음 단계

1. 베이스 커버를 설치합니다.
2. 배터리를 설치합니다.
3. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

SSD2 슬롯의 솔리드 스테이트 드라이브

SSD2 슬롯에서 M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 제거

전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 베이스 커버를 제거합니다.
3. 배터리를 제거합니다.

이 작업 정보

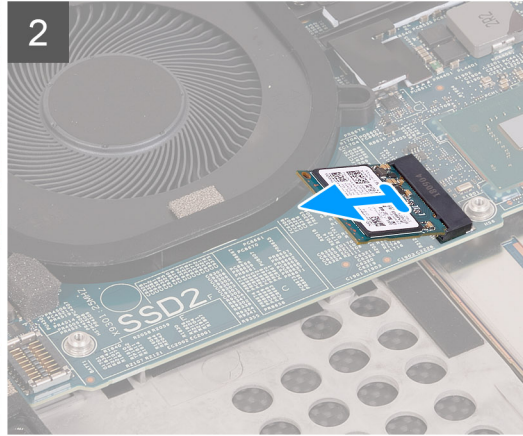
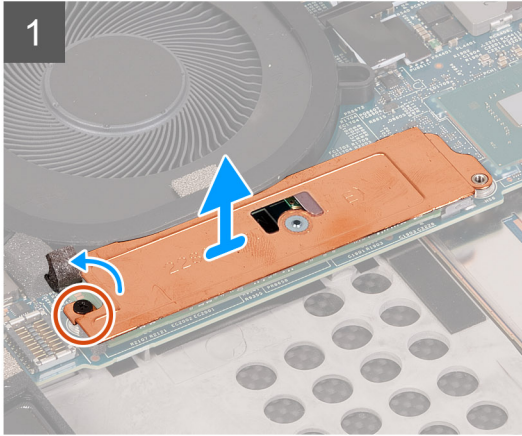
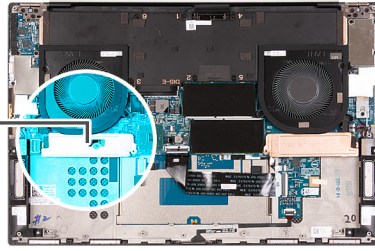
이 노트: 이 절차는 SSD2 슬롯에 M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브가 설치된 컴퓨터에만 적용됩니다.

이 노트: 주문한 구성에 따라 컴퓨터는 SSD2 슬롯에서 M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 또는 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브를 지원할 수 있습니다.

다음 이미지는 SSD2 슬롯에 설치된 M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



1x
M2x4



단계

1. 솔리드 스테이트 드라이브를 손목 받침대 및 키보드 어셈블리에 고정하는 나사(M2x4)를 제거합니다.
2. 솔리드 스테이트 드라이브를 밀어 시스템 보드의 SSD2 슬롯에서 들어 올립니다.

SSD2 슬롯에 M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

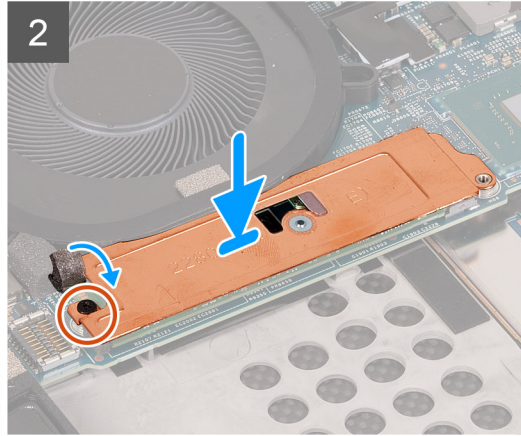
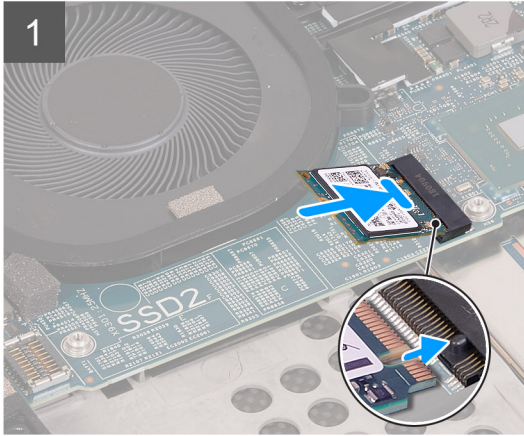
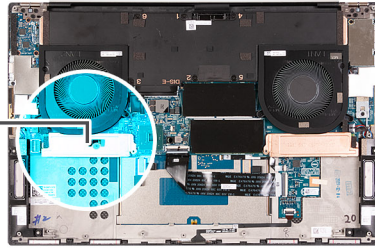
이 작업 정보

- 이 노트:** 이 절차는 SSD2 슬롯에 M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브가 설치된 컴퓨터에만 적용됩니다.
- 이 노트:** 주문한 구성에 따라 컴퓨터는 SSD2 슬롯에서 M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 또는 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브를 지원할 수 있습니다.
- 이 노트:** 솔리드 스테이트 드라이브 마운팅 브래킷이 설치되어 있지 않으면 설치합니다.

다음 이미지는 SSD2 슬롯에 설치된 M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



1x
M2x4



단계

1. 설치되지 않은 경우 솔리드 스테이트 드라이브 마운팅 브래킷을 팜레스트 및 키보드 어셈블리의 슬롯에 밀어 넣습니다.
2. 솔리드 스테이트 드라이브의 노치를 시스템 보드에 있는 SSD2 슬롯의 탭에 맞춥니다.
3. 솔리드 스테이트 드라이브를 시스템 보드의 SSD2 슬롯에 밀어 넣습니다.
4. 솔리드 스테이트 드라이브를 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 나사(M2x4)를 장착합니다.

다음 단계

1. 배터리를 설치합니다.
2. 베이스 커버를 설치합니다.
3. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

SSD2 슬롯에서 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브 제거

전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 베이스 커버를 제거합니다.
3. 배터리를 제거합니다.

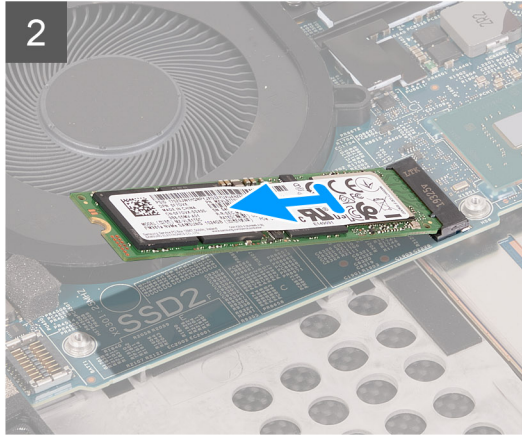
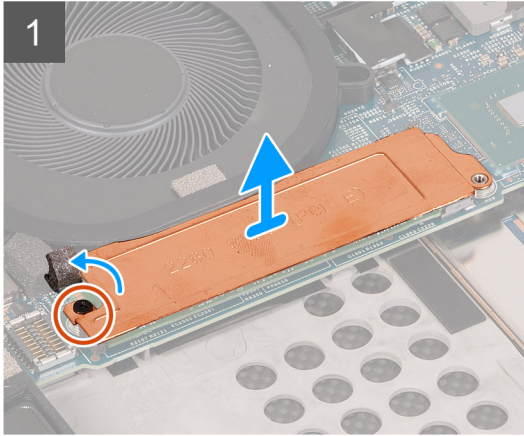
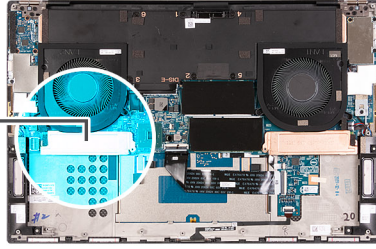
이 작업 정보

이 노트: 이 절차는 SSD2 슬롯에 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브가 설치된 컴퓨터에만 적용됩니다.

다음 이미지는 SSD2 슬롯에 설치된 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



1x
M2x4



단계

1. 솔리드 스테이트 드라이브 열 브래킷과 솔리드 스테이트 드라이브를 시스템 보드에 고정하는 M2x4 나사를 제거합니다.
2. 열판을 들어 올려 시스템 보드에서 분리합니다.
3. 솔리드 스테이트 드라이브를 밀어 SSD2 슬롯에서 들어냅니다.

SSD2 슬롯에 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브 설치

전제조건

구성 요소를 교체하는 경우 설치 절차를 수행하기 전에 기존 구성 요소부터 제거합니다.

이 작업 정보

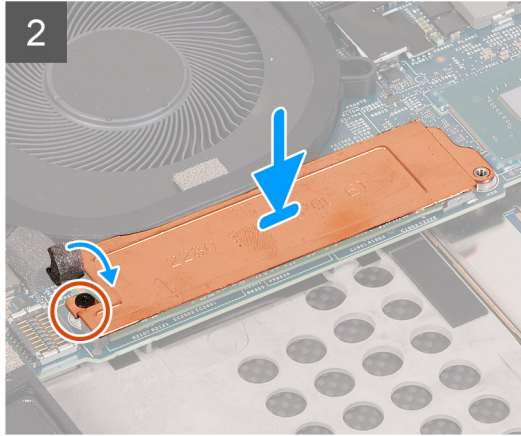
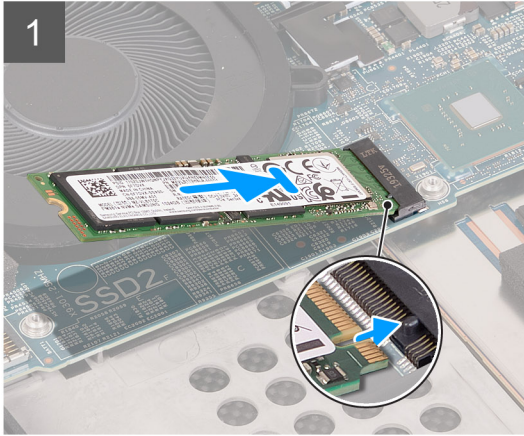
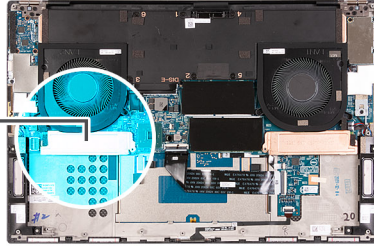
① 노트: 이 절차는 SSD2 슬롯에 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브가 설치된 컴퓨터에만 적용됩니다.

① 노트: 솔리드 스테이트 드라이브 마운팅 브래킷이 설치되어 있지 않으면 설치합니다.

다음 이미지는 SSD2 슬롯에 설치된 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



1x
M2x4



단계

1. 솔리드 스테이트 드라이브의 노치를 SSD2 슬롯의 탭에 맞춥니다.
2. 솔리드 스테이트 드라이브를 SSD2 슬롯에 밀어 넣습니다.
3. 가이드 포스트를 사용하여 솔리드 스테이트 드라이브 열 브래킷을 솔리드 스테이트 드라이브 위에 놓습니다.
4. 솔리드 스테이트 드라이브 열 브래킷의 나사 구멍을 시스템 보드의 나사 구멍에 맞춥니다.
5. 솔리드 스테이트 드라이브 열 브래킷과 솔리드 스테이트 드라이브를 시스템 보드에 고정하는 M2x4 나사를 장착합니다.
6. 솔리드 스테이트 드라이브 열 브래킷을 시스템 보드에 고정하는 테이프를 부착합니다.

다음 단계

1. 배터리를 설치합니다.
2. 베이스 커버를 설치합니다.
3. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

팬

팬 1 제거

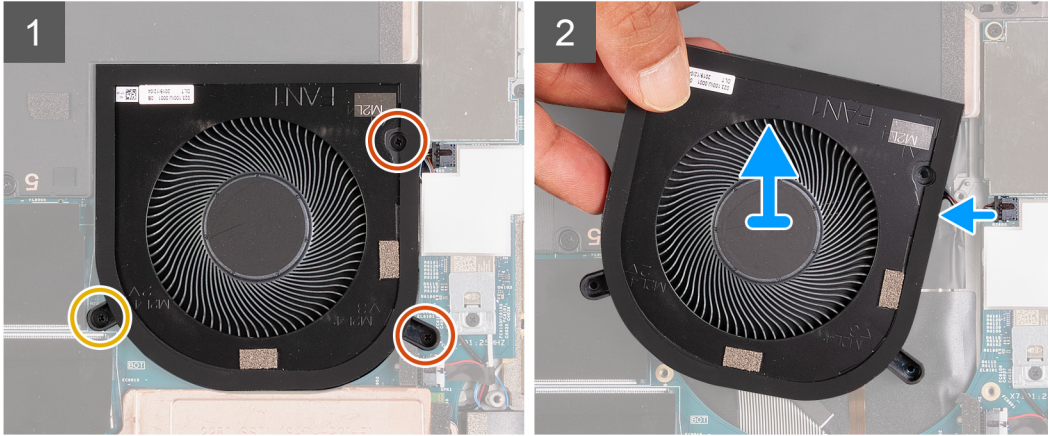
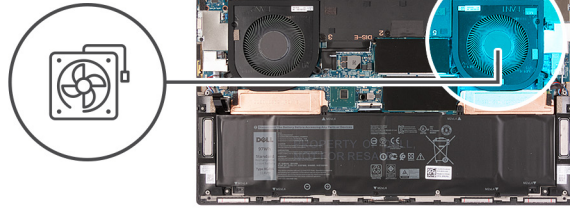
전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 베이스 커버를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 오른쪽 팬 1의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.

이 노트: 표시된 팬은 독립 그래픽이 포함된 시스템용이며, UMA 팬은 다르게 보일 수 있지만 동일한 방식으로 설치됩니다.



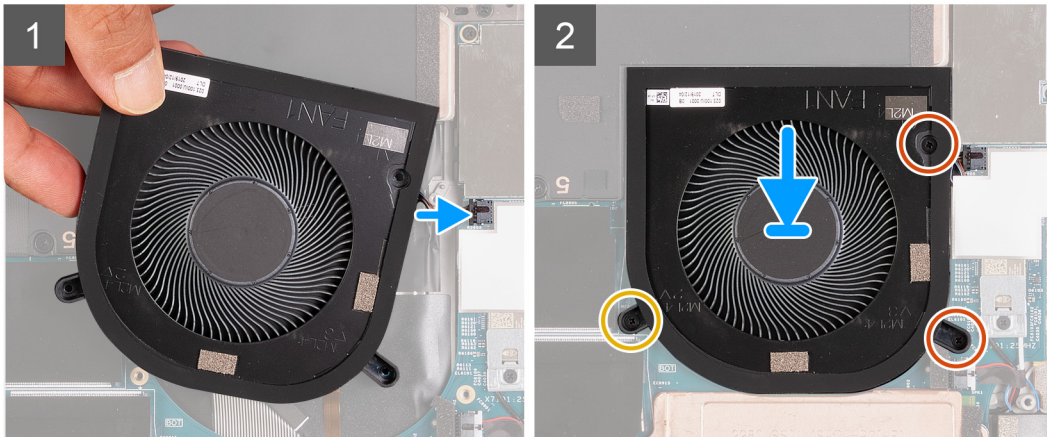
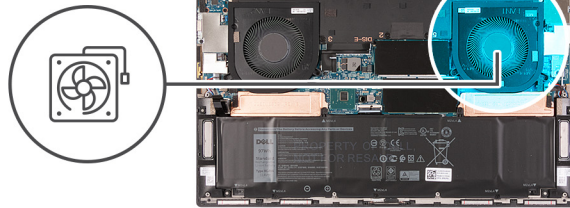
- 단계**
- 오른쪽 팬(팬 1)을 시스템 보드와 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 2개의 M2x4 나사와 1개의 M1.6x4 나사를 제거합니다.
 - 오른쪽 팬 케이블을 시스템 보드에서 연결 해제합니다.
 - 오른쪽 팬(FAN1)을 팜레스트 및 키보드 어셈블리에서 들어냅니다.

오른쪽 팬 설치

전제조건

이 작업 정보

다음 이미지는 팬 1의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

1. 시스템 보드에 오른쪽 팬(팬 1) 케이블을 연결합니다.
2. 팬 1의 나사 구멍을 팜레스트 및 키보드 어셈블리와 시스템 보드의 나사 구멍에 맞춥니다.
3. 오른쪽 팬(팬 1)을 시스템 보드와 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 2개의 M2x4 나사와 1개의 M1.6x4 나사를 장착합니다.

다음 단계

1. 베이스 커버를 설치합니다.
2. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

팬 2 제거

전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 베이스 커버를 제거합니다.

이 작업 정보

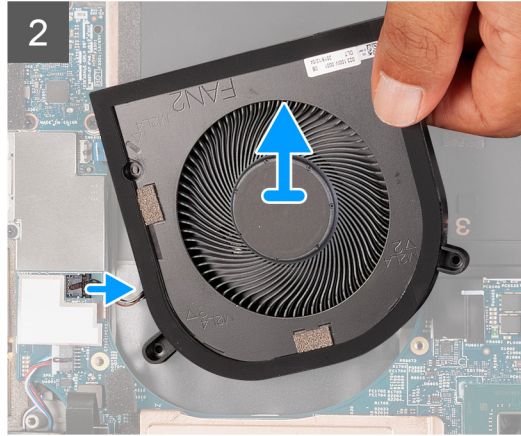
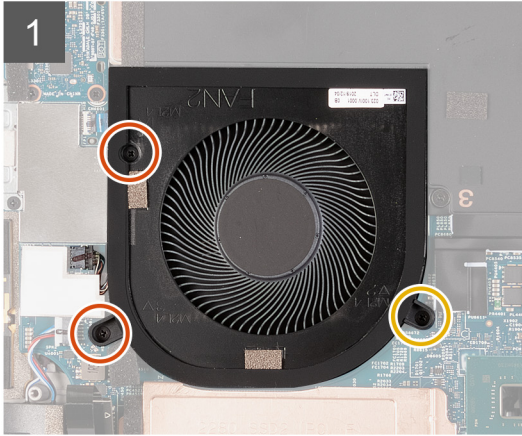
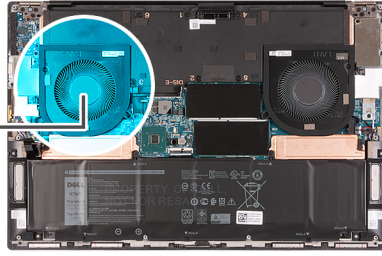
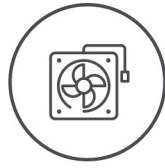
다음 이미지는 팬 2의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



2x
M2x4



1x
M1.6x4



단계

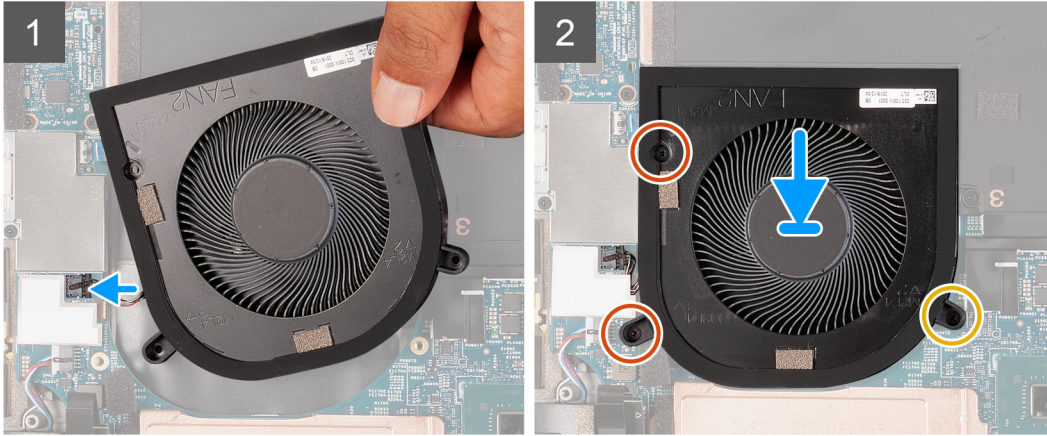
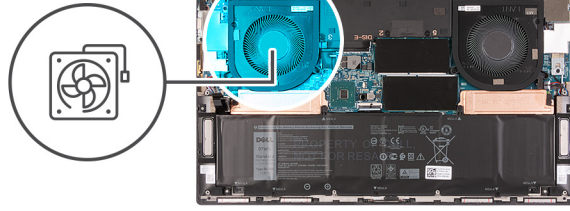
1. 왼쪽 팬(팬 2)을 시스템 보드와 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 2개의 M2x4 나사와 1개의 M1.6x4 나사를 제거합니다.
2. 시스템 보드에서 팬 케이블을 분리합니다.
3. 왼쪽 팬(팬 2)을 들어 올려 팜레스트 및 키보드 어셈블리에서 분리합니다.

왼쪽 팬 설치

전제조건

이 작업 정보

다음 이미지는 팬 2의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

1. 왼쪽 팬(팬 2)의 나사 구멍을 시스템 보드와 팜레스트 및 키보드 어셈블리의 나사 구멍에 맞춥니다.
2. 왼쪽 팬(팬 2)을 시스템 보드와 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 2개의 M2x4 나사와 1개의 M1.6x4 나사를 장착합니다.
3. 시스템 보드에 왼쪽 팬(팬 2) 케이블을 연결합니다.

다음 단계

1. 베이스 커버를 설치합니다.
2. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

방열판

방열판 제거(통합형 그래픽 카드와 함께 제공되는 컴퓨터에 해당)

전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
 △ 주의: 프로세서의 최대 냉각 기능을 보장하려면 프로세서 방열판의 열 전달 영역을 만지지 마십시오. 피부에 묻어있는 오일은 열 그리스의 열 전달 기능을 저하시킬 수 있습니다.

① 노트: 방열판은 정상 운영 중에 뜨거워질 수 있습니다. 충분한 시간 동안 방열판을 식힌 후에 만지도록 하십시오.

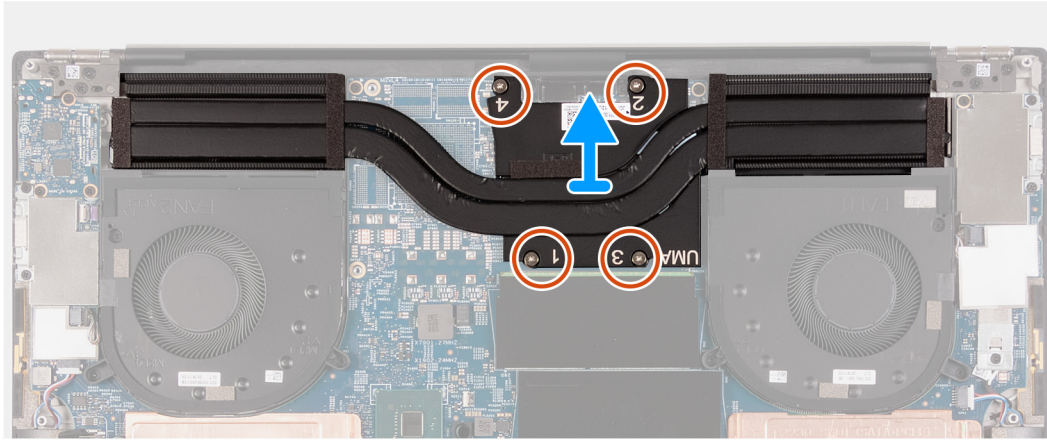
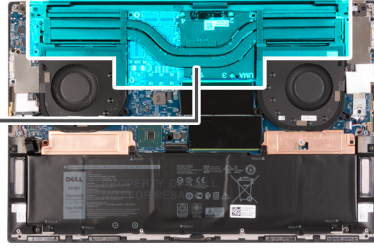
2. 베이스 커버를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 방열판의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



4x
M2x6.5



단계

1. 방열판에 표시된 숫자의 반대 순서로 방열판을 시스템 보드에 고정하는 4개의 나사(M2x6.5)를 제거합니다.
2. 방열판을 들어 올려 시스템 보드에서 분리합니다.

방열판 설치(통합형 그래픽 카드와 함께 제공되는 컴퓨터에 해당)

전제조건

△ 주의: 방열판을 잘못 맞추면 시스템 보드와 프로세서가 손상될 수 있습니다.

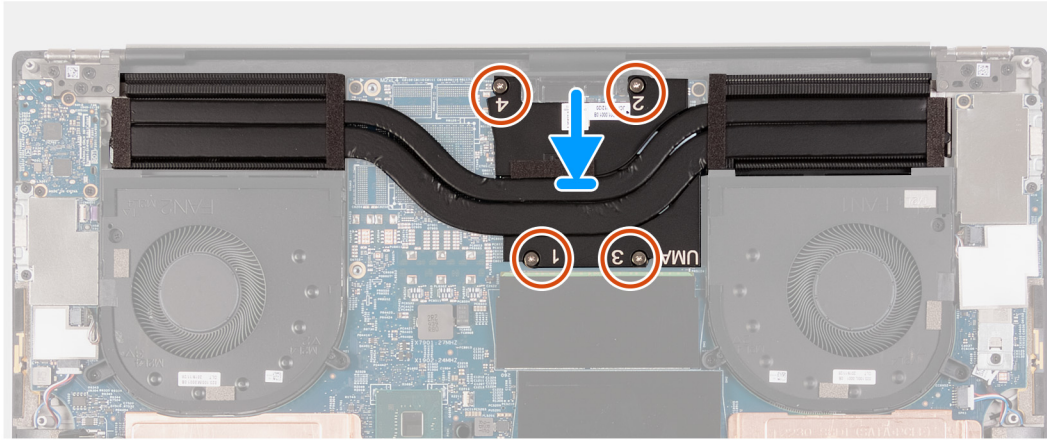
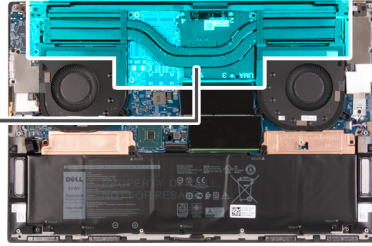
① 노트: 시스템 보드 또는 방열판을 교체한 경우 키트에 제공된 방열 패드나 열 그리스를 사용하여 열 전도성을 확보합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 방열판의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



4x
M2x6.5



단계

1. 방열판의 나사 구멍을 시스템 보드의 나사 구멍에 맞춥니다.
2. 방열판에 표시된 숫자 순서대로 방열판을 시스템 보드에 고정하는 4개의 M2x6.5 나사를 장착합니다.

다음 단계

1. 베이스 커버를 설치합니다.
2. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

방열판 제거

전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.

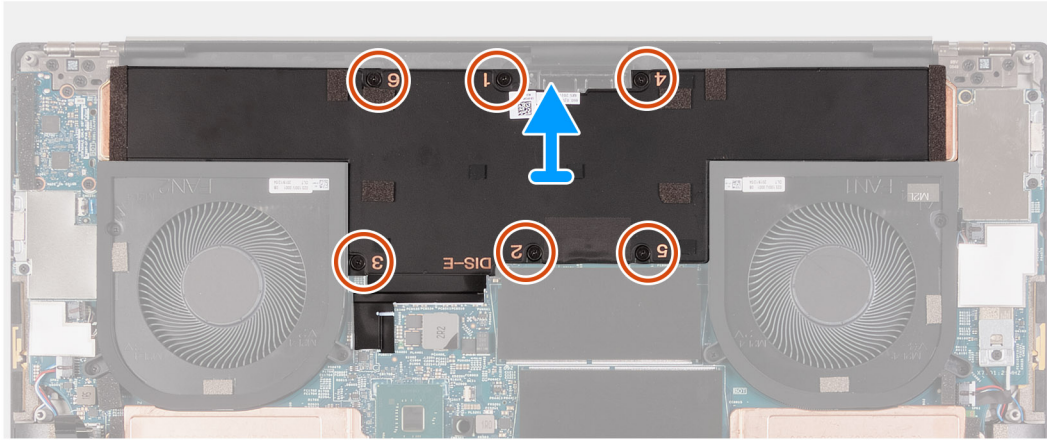
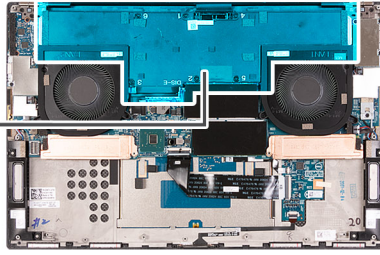
주의: 프로세서의 최대 냉각 기능을 보장하려면 프로세서 방열판의 열 전달 영역을 만지지 마십시오. 피부에 묻어있는 오일은 열 그리스의 열 전달 기능을 저하시킬 수 있습니다.

노트: 방열판은 정상 운영 중에 뜨거워질 수 있습니다. 충분한 시간 동안 방열판을 식힌 후에 만지도록 하십시오.

2. 베이스 커버를 제거합니다.
3. 배터리를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 방열판의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



단계

1. 방열판에 표시된 숫자의 반대 순서로 방열판을 시스템 보드에 고정하는 나사를 제거합니다.
 - 내장형 그래픽 카드가 있는 시스템 보드용 방열판: 4개의 나사(M2.5x6)
 - 독립 그래픽 카드가 있는 시스템 보드용 방열판: 6개의 나사(M2.5x6)
2. 방열판을 들어 올려 시스템 보드에서 분리합니다.

방열판 설치

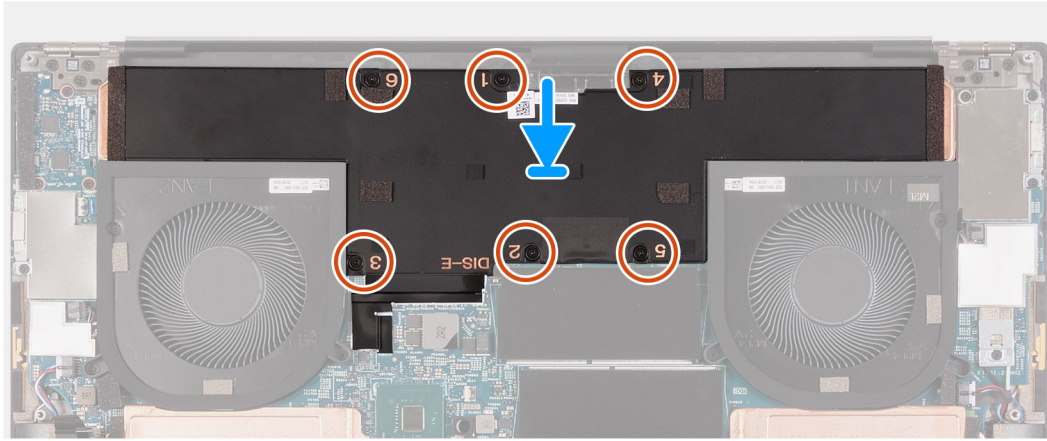
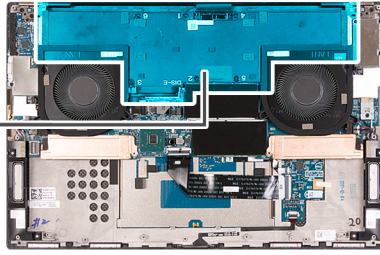
전제조건

⚠ 주의: 방열판을 잘못 맞추면 시스템 보드와 프로세서가 손상될 수 있습니다.

ℹ 노트: 시스템 보드 또는 방열판을 교체한 경우 키트에 제공된 방열 패드나 열 그리스를 사용하여 열 전도성을 확보합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 방열판의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



단계

1. 방열판의 나사 구멍을 시스템 보드의 나사 구멍에 맞춥니다.
2. 방열판에 표시된 숫자 순서대로 방열판을 시스템 보드에 고정하는 나사를 장착합니다.
 - 내장형 그래픽 카드가 있는 시스템 보드용 방열판: 4개의 나사(M2.5x6)
 - 독립 그래픽 카드가 있는 시스템 보드용 방열판: 6개의 나사(M2.5x6)

다음 단계

1. 배터리를 설치합니다.
2. 베이스 커버를 설치합니다.
3. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

I/O 보드

I/O 보드 제거

전제조건

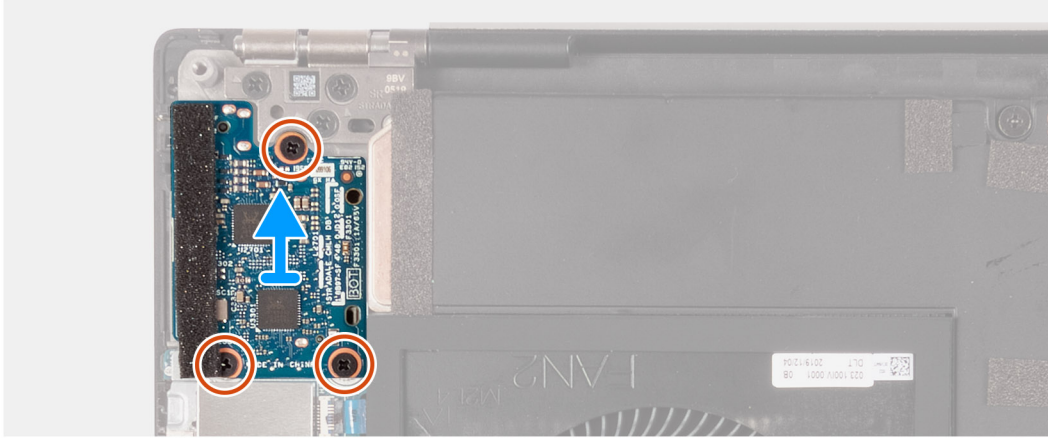
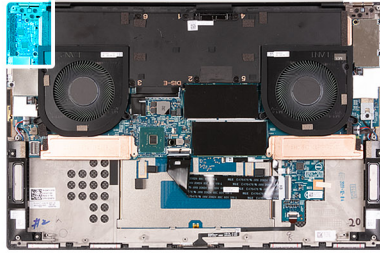
1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 베이스 커버를 제거합니다.
3. 배터리를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 I/O 보드의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



3x
M2x4



단계

1. I/O 보드 케이블을 시스템 보드 및 I/O 보드에서 연결 해제합니다.
2. I/O 보드 케이블을 시스템 보드에서 들어냅니다.
3. I/O 보드를 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 3개의 나사(M2x4)를 제거합니다.
4. I/O 보드를 들어 올려 팜레스트 및 키보드 어셈블리에서 분리합니다.

I/O 보드 설치

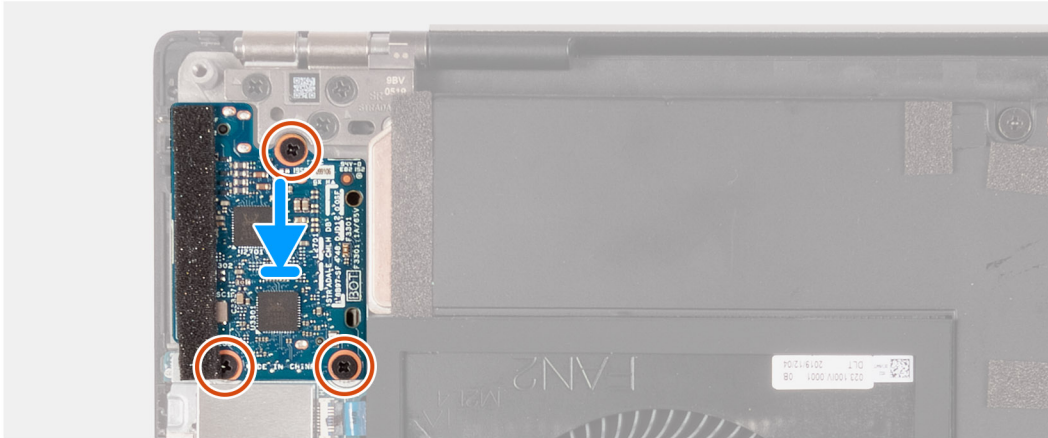
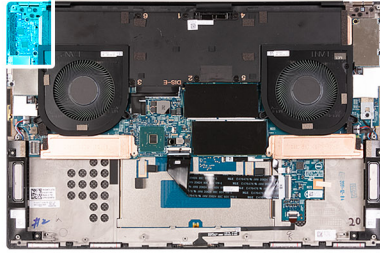
전제조건

이 작업 정보

다음 이미지는 I/O 보드의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



3x
M2x4



단계

1. I/O 보드의 나사 구멍을 팜레스트 및 키보드 어셈블리의 나사 구멍에 맞춥니다.
2. I/O 보드를 손목 받침대 및 키보드 어셈블리에 고정하는 3개의 나사(M2x4)를 장착합니다.
3. I/O 보드 케이블을 I/O 보드 및 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다.

다음 단계

1. 배터리를 설치합니다.
2. 베이스 커버를 설치합니다.
3. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

디스플레이 어셈블리

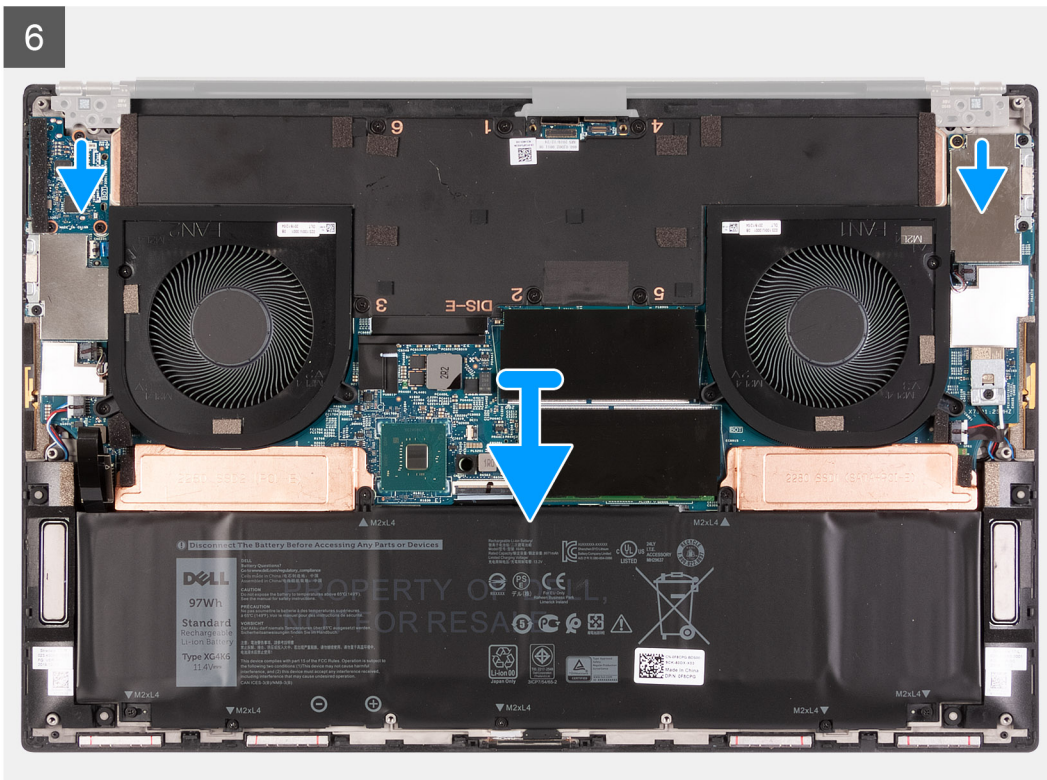
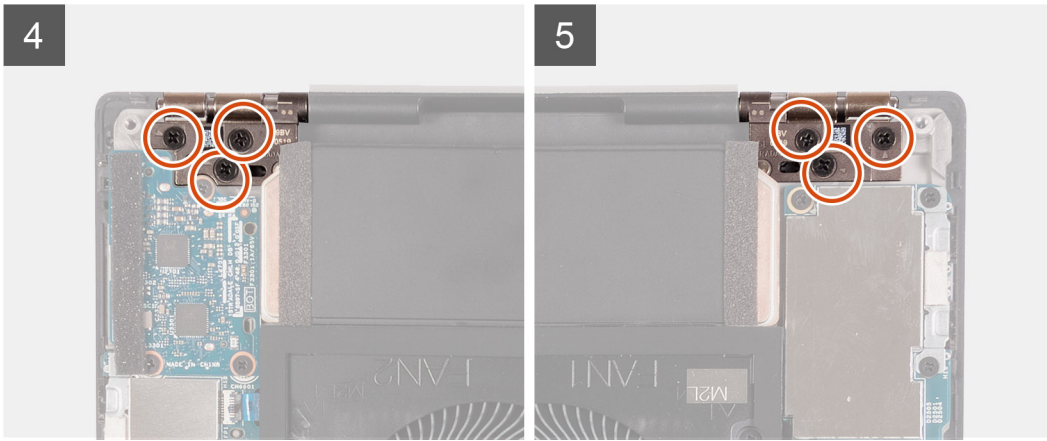
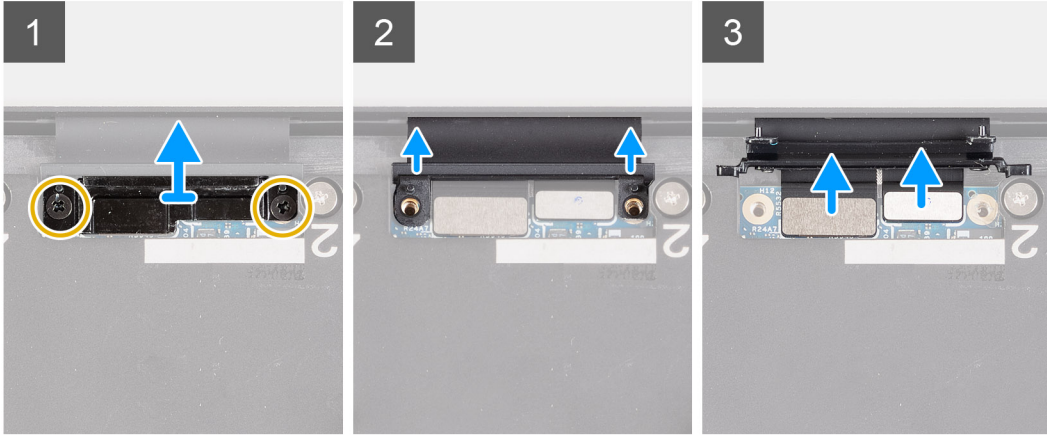
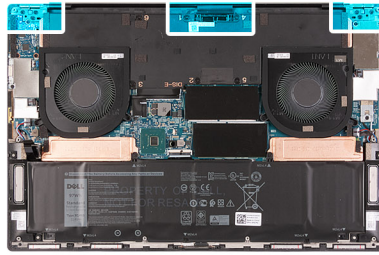
디스플레이 어셈블리 제거

전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 베이스 커버를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 디스플레이 케이블과 디스플레이 힌지의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



단계

1. 디스플레이 케이블 브래킷을 시스템 보드에 고정하는 2개의 나사(M2x4)를 제거합니다.
2. 디스플레이 어셈블리 케이블 브래킷을 들어올려 시스템 보드에서 분리합니다.
3. 카메라 커넥터와 디스플레이 커넥터를 시스템 보드에서 밀어 시스템 보드에서 연결 해제합니다.
4. 왼쪽 디스플레이 힌지를 손목 받침대 및 키보드 어셈블리에 고정하는 3개의 나사(M2.5x5)를 제거합니다.
5. 오른쪽 디스플레이 힌지를 손목 받침대 및 키보드 어셈블리에 고정하는 3개의 나사(M2.5x5)를 제거합니다.
6. 왼쪽 및 오른쪽 힌지를 팜레스트 및 키보드 어셈블리에서 들어 올립니다.
7. 손목 받침대 및 키보드 어셈블리를 디스플레이 어셈블리에서 밀어냅니다.
8. 위의 모든 단계를 수행하고 나면 디스플레이 어셈블리가 남습니다.



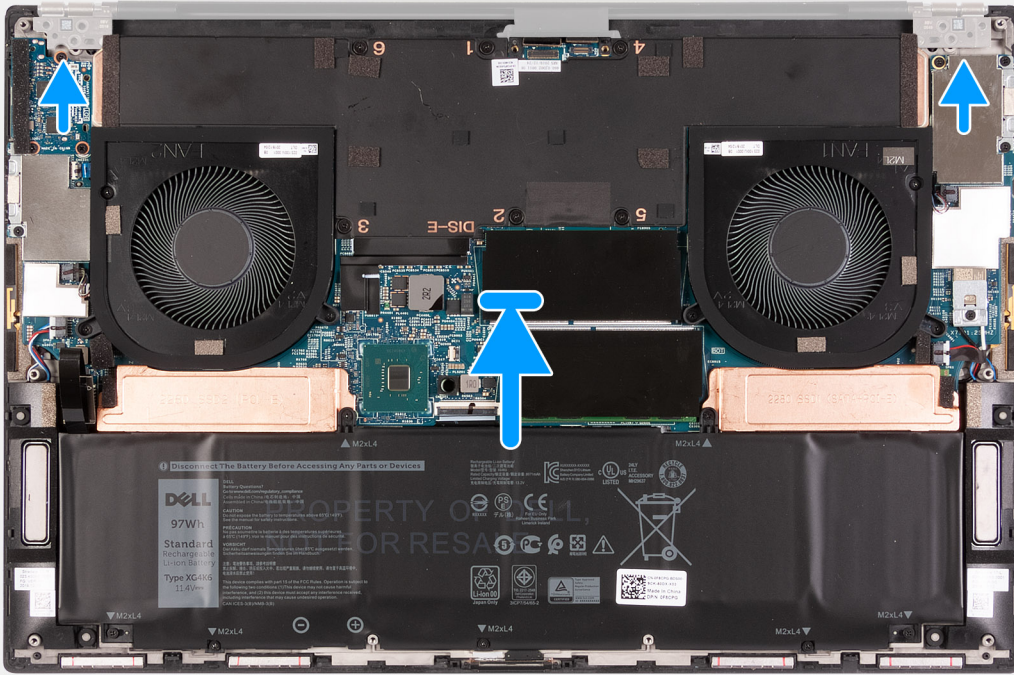
디스플레이 어셈블리 설치

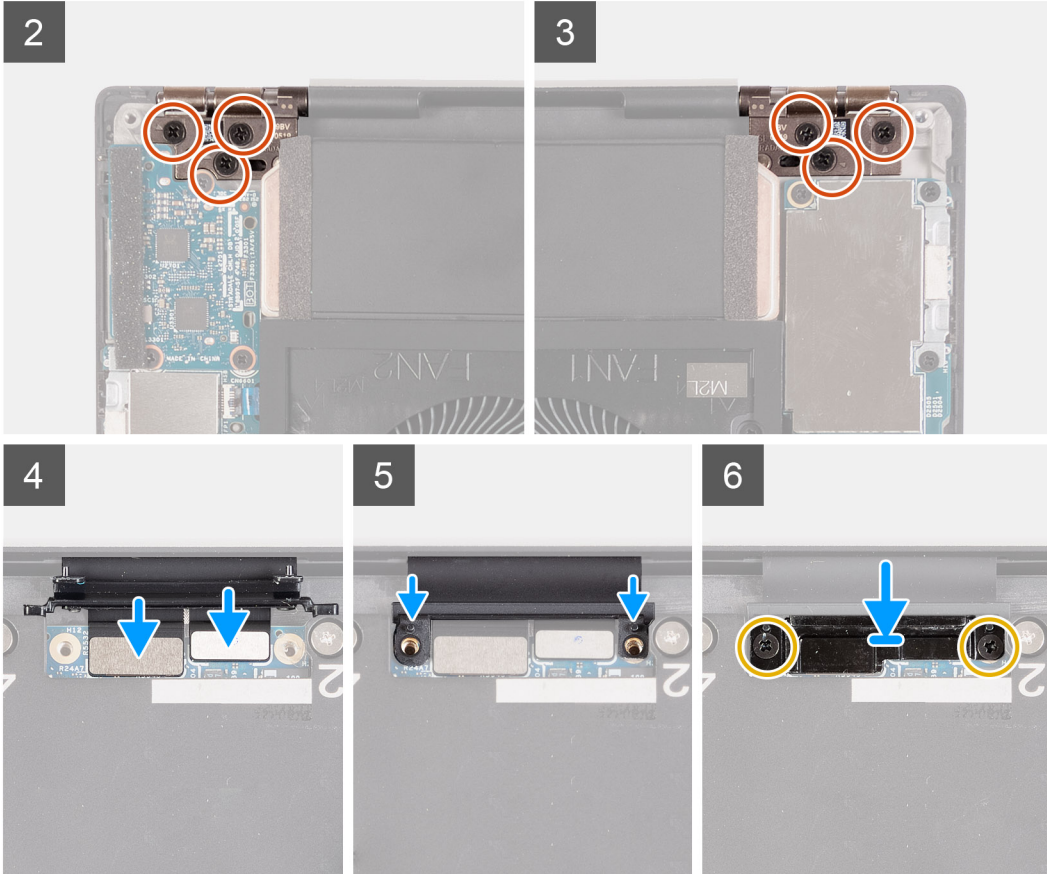
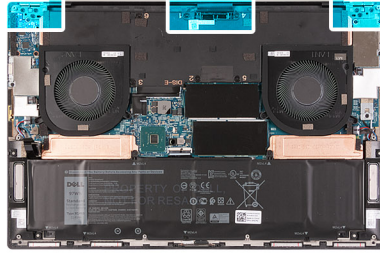
전제조건

이 작업 정보

다음 이미지는 디스플레이 케이블과 디스플레이 힌지의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.

1





단계

1. 손목 받침대 및 키보드 어셈블리를 디스플레이 어셈블리 힌지 아래에서 밀습니다.
2. 팜레스트 어셈블리의 나사 구멍을 오른쪽 및 왼쪽 디스플레이 힌지의 나사 구멍에 맞춥니다.
3. 왼쪽 디스플레이 힌지를 시스템 보드와 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 3개의 나사(M2.5x5)를 장착합니다.
4. 오른쪽 디스플레이 힌지를 시스템 보드와 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 3개의 나사(M2.5x5)를 장착합니다.
5. 디스플레이 케이블과 카메라 케이블을 디스플레이 어셈블리 케이블에 연결합니다.
6. 디스플레이 어셈블리 케이블 브래킷의 나사 구멍을 시스템 보드의 나사 구멍에 맞춥니다.
7. 디스플레이 어셈블리 케이블 브래킷을 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 2개의 M2x4 나사를 장착합니다.

이 노트: 2개의 M2x4 나사를 조일 때 토크를 조심스럽게 가하여 나사산의 손상을 방지합니다.

다음 단계

1. **베이스 커버**를 설치합니다.
2. **컴퓨터 내부 작업을 마친 후에**의 절차를 따릅니다.

시스템 보드

시스템 보드 제거

전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.

① 노트: 컴퓨터의 서비스 태그는 시스템 보드에 저장되어 있습니다. 시스템 보드를 교체한 후 BIOS 설정 프로그램에서 서비스 태그를 입력합니다.

① 노트: 시스템 보드를 교체하면 BIOS 설정 프로그램을 사용하여 변경된 BIOS 변경사항이 모두 제거됩니다. 시스템 보드를 교체한 후 적절히 변경합니다.

① 노트: 시스템 보드에서 케이블을 분리하기 전에 커넥터의 위치를 기록하여 시스템 보드를 교체한 후에 정확하게 다시 연결할 수 있도록 합니다.

2. 베이스 커버를 제거합니다.

3. 배터리를 제거합니다.

4. 메모리 모듈을 제거합니다.

5. M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 또는 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브를 SSD1 슬롯에서 제거합니다.

6. M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 또는 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브를 SSD2 슬롯에서 제거합니다.

7. 방열판을 분리합니다.

① 노트: 시스템 보드는 방열판이 부착된 상태로 함께 제거하거나 설치할 수 있습니다. 이렇게 하면 절차가 단순화되고 시스템 보드와 방열판 간의 열 결합 손상이 방지됩니다.

8. 오른쪽 팬을 제거합니다.

9. 왼쪽 팬을 제거합니다.

10. I/O 보드를 분리합니다.

11. 디스플레이 어셈블리를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 시스템 보드에 있는 커넥터의 위치를 나타냅니다.

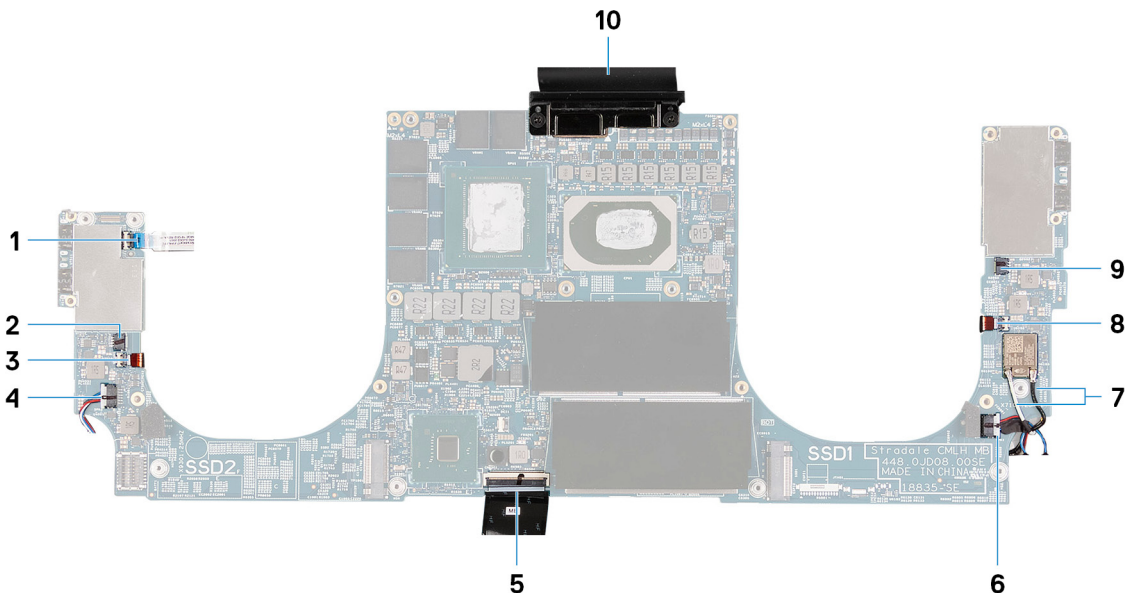


그림 3. 시스템 보드 커넥터

- | | |
|--|----------------|
| 1. 전원 버튼 커넥터 | 2. 왼쪽 팬 커넥터 |
| 3. 왼쪽 안테나 케이블(활성 안테나와 함께 제공되는 컴퓨터만 해당) | 4. 왼쪽 스피커 케이블 |
| 5. 키보드 케이블 | 6. 오른쪽 스피커 케이블 |

7. 안테나 케이블

9. 오른쪽 팬 케이블

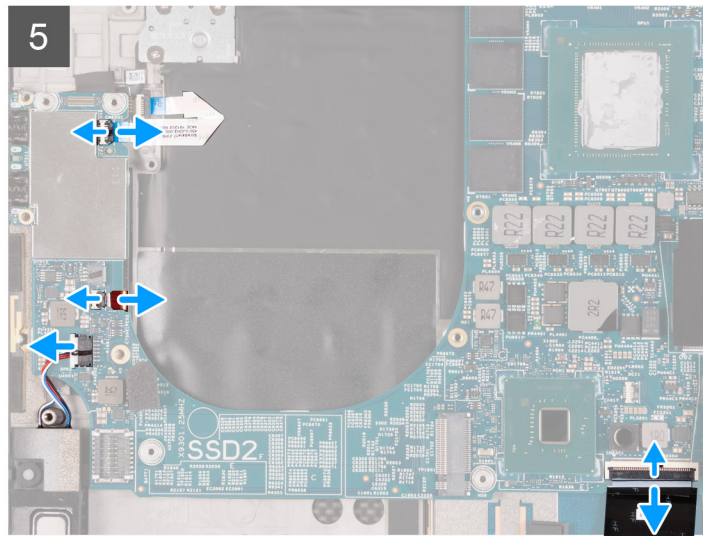
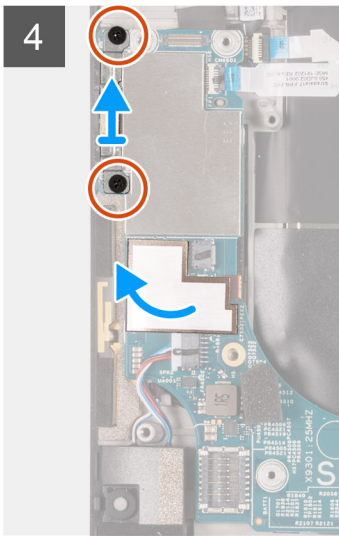
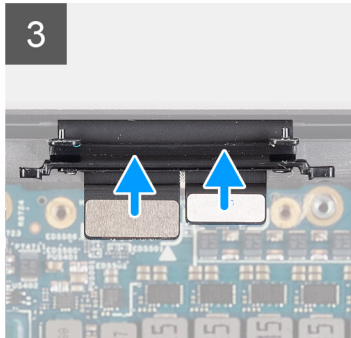
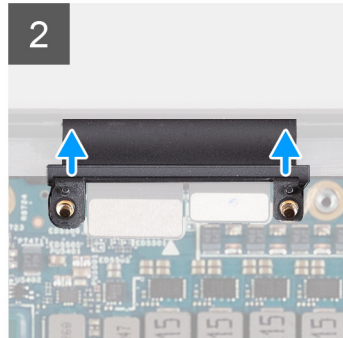
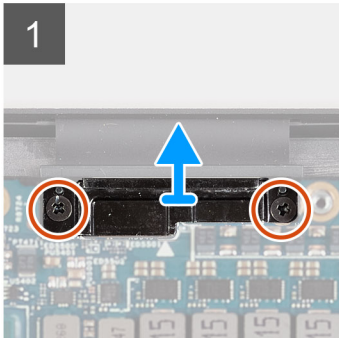
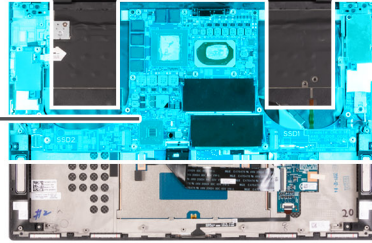
8. 오른쪽 안테나 케이블(활성 안테나와 함께 제공되는 컴퓨터만 해당)

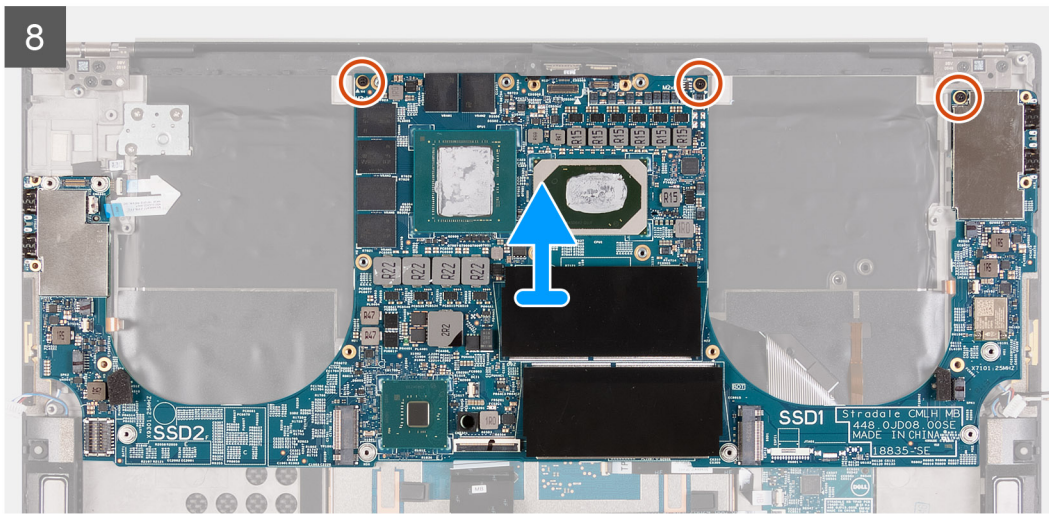
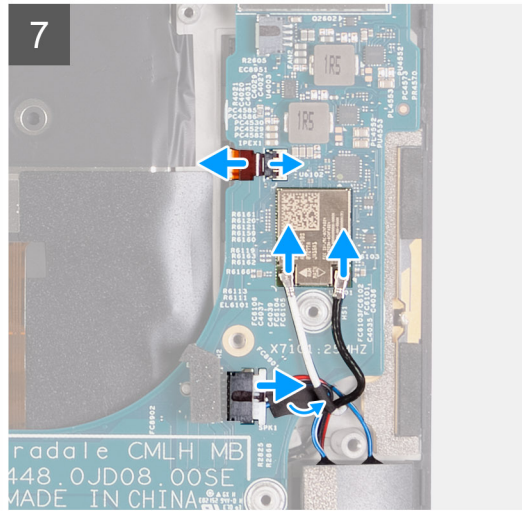
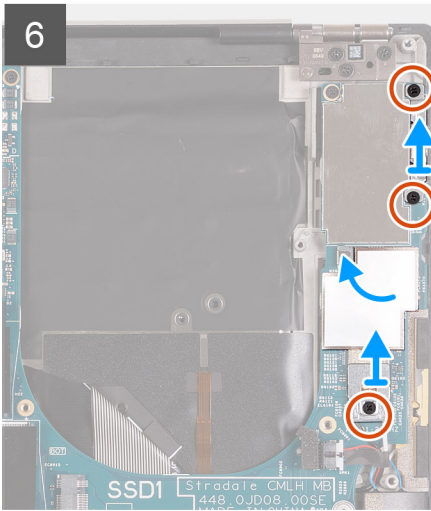
10. 디스플레이 케이블

다음 이미지는 시스템 보드의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



10x
M2x4





단계

1. 디스플레이 어셈블리 케이블 브래킷을 시스템 보드에 고정하는 2개의 나사(M2x4)를 제거합니다.
2. 디스플레이 어셈블리 케이블 브래킷을 들어올려 시스템 보드에서 분리합니다.
3. 카메라 케이블 및 디스플레이 케이블을 시스템 보드에서 연결 해제합니다.
4. USB Type-C 포트 브래킷을 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 2개의 M2x4 나사를 제거합니다.
5. 우퍼 케이블과 스피커 케이블을 시스템 보드에 고정하는 마일라 테이프를 떼어냅니다.
6. 래치를 열고 시스템 보드에서 전원 버튼 케이블을 분리합니다.
7. 래치를 열고 우퍼 케이블을 시스템 보드에서 연결 해제합니다.
8. 시스템 보드에서 스피커 케이블을 분리합니다.
9. 시스템 보드에서 키보드 케이블을 분리합니다.
10. USB Type-C 포트 브래킷을 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 2개의 M2x4 나사를 제거합니다.
11. 우퍼 케이블과 스피커 케이블을 시스템 보드에 고정하는 마일라를 떼어냅니다.
12. 무선 카드 브래킷을 시스템 보드에 고정하는 나사(M2x4)를 제거합니다.
13. 래치를 열고 우퍼 케이블을 시스템 보드에서 연결 해제합니다.
14. 무선 카드에서 안테나 케이블을 분리합니다.
15. 시스템 보드에서 스피커 케이블을 분리합니다.
16. 시스템 보드를 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 3개의 나사(M2x4)를 제거합니다.
17. 시스템 보드를 들어 올려 팜레스트 및 키보드 어셈블리에서 분리합니다.

시스템 보드 설치

전제조건

- ① **노트:** 컴퓨터의 서비스 태그는 시스템 보드에 저장되어 있습니다. 시스템 보드를 교체한 후 BIOS 설정 프로그램에서 서비스 태그를 입력합니다.
- ① **노트:** 시스템 보드를 교체하면 BIOS 설정 프로그램을 사용하여 변경된 BIOS 변경사항이 모두 제거됩니다. 시스템 보드를 교체한 후 적절히 변경합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 시스템 보드에 있는 커넥터의 위치를 나타냅니다.

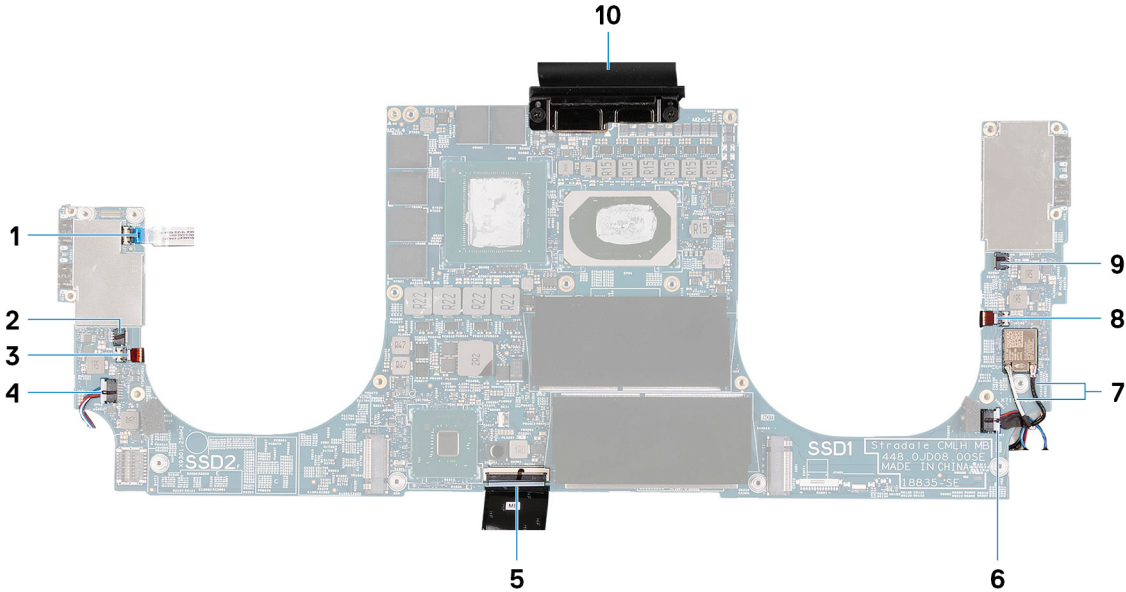


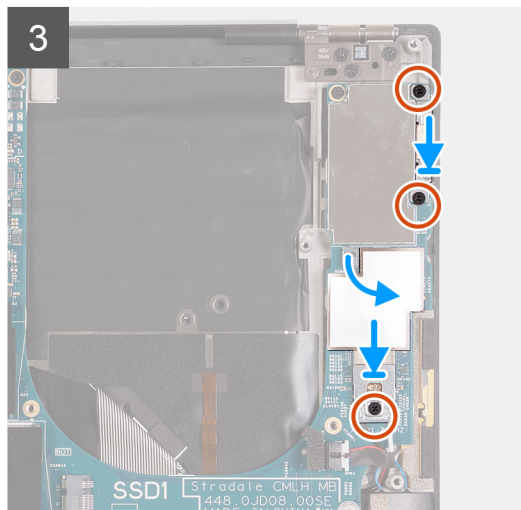
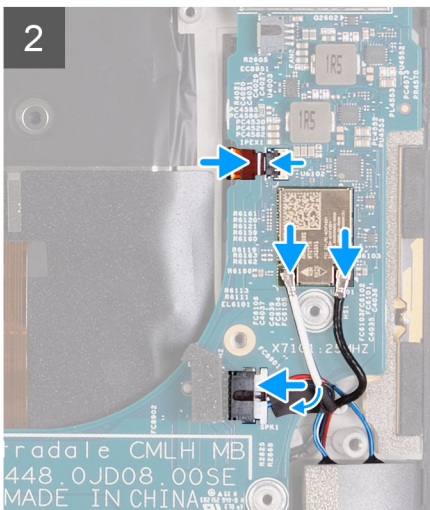
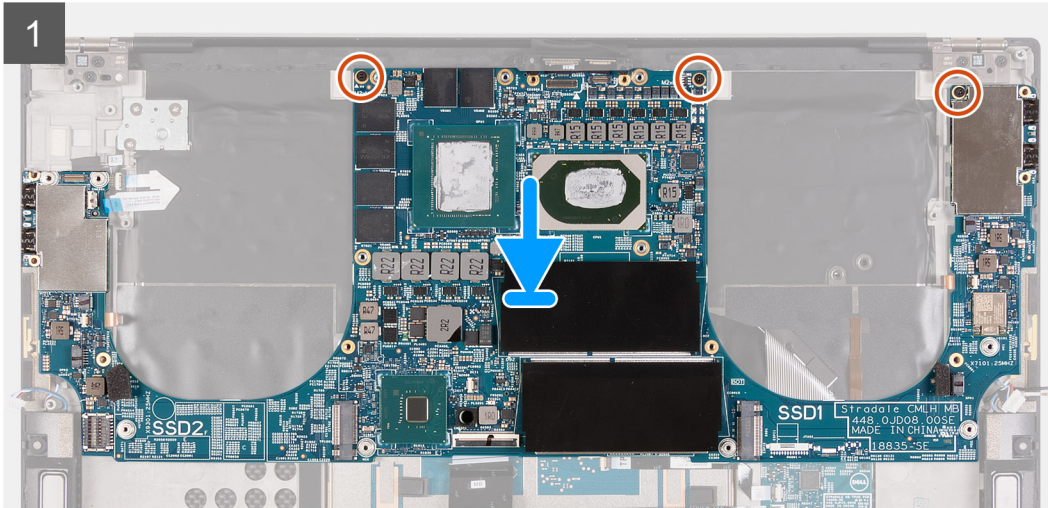
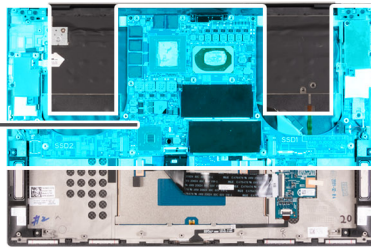
그림 4. 시스템 보드 커넥터

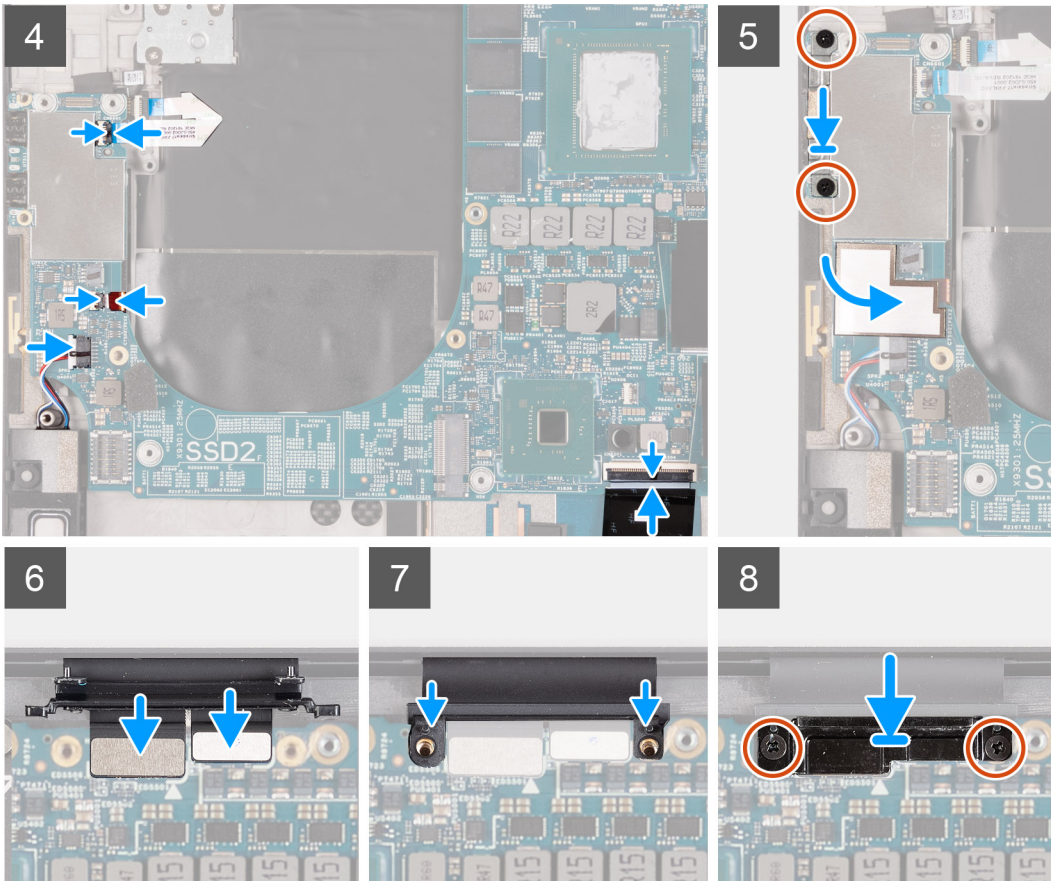
- | | |
|--|---|
| 1. 전원 버튼 커넥터 | 2. 왼쪽 팬 커넥터 |
| 3. 왼쪽 안테나 케이블(활성 안테나와 함께 제공되는 컴퓨터만 해당) | 4. 왼쪽 스피커 케이블 |
| 5. 키보드 케이블 | 6. 오른쪽 스피커 케이블 |
| 7. 안테나 케이블 | 8. 오른쪽 안테나 케이블(활성 안테나와 함께 제공되는 컴퓨터만 해당) |
| 9. 오른쪽 팬 케이블 | 10. 디스플레이 케이블 |

다음 이미지는 시스템 보드의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



10x
M2x4





단계

1. 시스템 보드의 나사 구멍을 손목 받침대 및 키보드 어셈블리의 나사 구멍에 맞춥니다.
2. 시스템 보드를 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 3개의 나사(M2x4)를 장착합니다.
3. 우퍼 케이블을 시스템 보드에 연결하고 래치를 닫아 우퍼 케이블을 시스템 보드에 고정합니다.
4. 무선 카드에 안테나 케이블을 연결합니다.

다음 표에는 컴퓨터에서 지원되는 무선 카드의 안테나 케이블 색상표가 제공됩니다.

표 3. 안테나 케이블 색상표

무선 카드의 커넥터	안테나 케이블 색상
주(흰색 삼각형)	흰색
보조(검정색 삼각형)	검정색

5. 스피커 케이블을 시스템 보드에 연결하고 래치를 닫아 스피커 케이블을 시스템 보드에 고정합니다.
6. USB Type-C 포트 브래킷을 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 2개의 M2x4 나사를 장착합니다.
7. 우퍼 커넥터와 스피커 커넥터를 시스템 보드에 고정하는 마일라 테이프를 부착합니다.
8. 무선 카드 브래킷을 시스템 보드에 고정하는 M2x4 나사를 장착합니다.
9. 전원 버튼 케이블을 시스템 보드에 연결하고 래치를 닫아 전원 버튼 케이블을 시스템 보드에 고정합니다.
10. 우퍼 케이블을 시스템 보드에 연결하고 래치를 닫아 우퍼 케이블을 시스템 보드에 고정합니다.
11. 스피커 케이블을 시스템 보드에 연결하고 래치를 닫아 스피커 케이블을 시스템 보드에 고정합니다.
12. USB Type-C 포트 브래킷을 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 2개의 M2x4 나사를 장착합니다.
13. 우퍼 커넥터와 스피커 커넥터를 시스템 보드에 고정하는 마일라 테이프를 부착합니다.
14. 디스플레이 케이블과 카메라 케이블을 디스플레이 어셈블리 케이블에 연결합니다.
15. 디스플레이 어셈블리 케이블 브래킷의 나사 구멍을 시스템 보드의 나사 구멍에 맞춥니다.
16. 디스플레이 어셈블리 케이블 홀더를 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 2개의 M2x4 나사를 장착합니다.

이 노트: 2개의 M2x4 나사를 조일 때 토크를 조심스럽게 가하여 나사산의 손상을 방지합니다.

다음 단계

1. 디스플레이 어셈블리를 설치합니다.
2. I/O 보드를 설치합니다.
3. 오른쪽 팬을 설치합니다.
4. 왼쪽 팬을 설치합니다.
5. 방열판을 설치합니다.
6. M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 또는 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브를 SSD2 슬롯에 설치합니다.
7. M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 또는 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브를 SSD1 슬롯에 설치합니다.
8. 메모리 모듈을 설치합니다.
9. 배터리를 설치합니다.
10. 베이스 커버를 설치합니다.
11. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

안테나

안테나 제거

전제조건

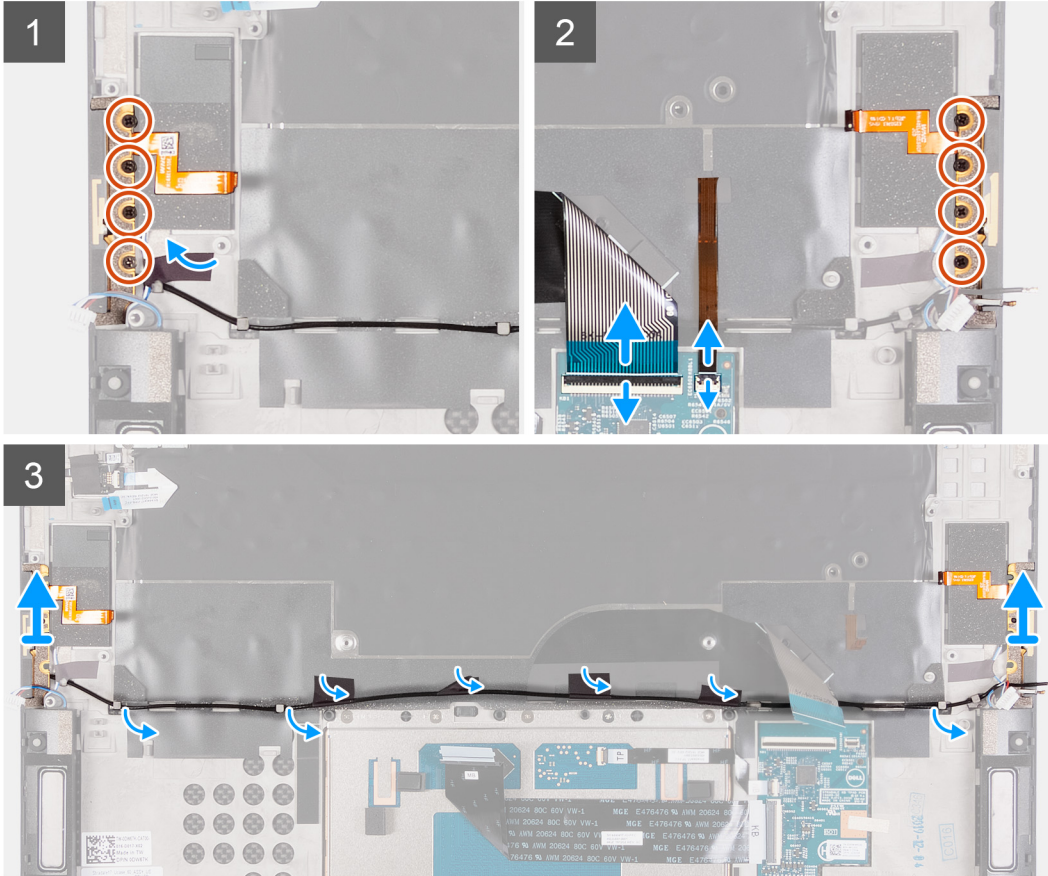
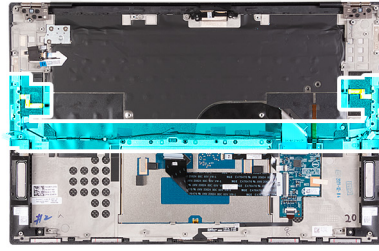
1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
 - 이 노트:** 컴퓨터의 서비스 태그는 시스템 보드에 저장되어 있습니다. 시스템 보드를 교체한 후 BIOS 설정 프로그램에서 서비스 태그를 입력합니다.
 - 이 노트:** 시스템 보드를 교체하면 BIOS 설정 프로그램을 사용하여 변경된 BIOS 변경사항이 모두 제거됩니다. 시스템 보드를 교체한 후 적절히 변경합니다.
 - 이 노트:** 시스템 보드에서 케이블을 분리하기 전에 커넥터의 위치를 기록하여 시스템 보드를 교체한 후에 정확하게 다시 연결할 수 있도록 합니다.
2. 베이스 커버를 제거합니다.
3. 배터리를 제거합니다.
4. 메모리 모듈을 제거합니다.
5. M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 또는 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브를 SSD1 슬롯에서 제거합니다.
6. M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 또는 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브를 SSD2 슬롯에서 제거합니다.
7. 방열판을 분리합니다.
 - 이 노트:** 시스템 보드는 방열판이 부착된 상태로 함께 제거하거나 설치할 수 있습니다. 이렇게 하면 절차가 단순화되고 시스템 보드와 방열판 간의 열 결합 손상이 방지됩니다.
8. 팬 1을 제거합니다.
9. 팬 2를 제거합니다.
10. I/O 보드를 분리합니다.
11. 디스플레이 어셈블리를 제거합니다.
12. 시스템 보드를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 안테나의 위치를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여줍니다.



8x
M2x2



단계

1. 오른쪽 안테나를 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 4개의 나사(M2x2)를 제거합니다.
2. 왼쪽 안테나를 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 4개의 나사(M2x2)를 제거합니다.
3. 팜레스트 및 키보드 어셈블리의 라우팅 가이드를 통하는 안테나 케이블의 라우팅을 기록해 둡니다.
4. 안테나 케이블을 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 테이프를 떼어냅니다.
5. 안테나 케이블을 팜레스트 및 키보드 어셈블리의 라우팅 가이드에서 제거합니다.
6. 왼쪽 및 오른쪽 안테나를 해당 케이블과 함께 팜레스트 및 키보드 어셈블리에서 들어냅니다.

안테나 설치

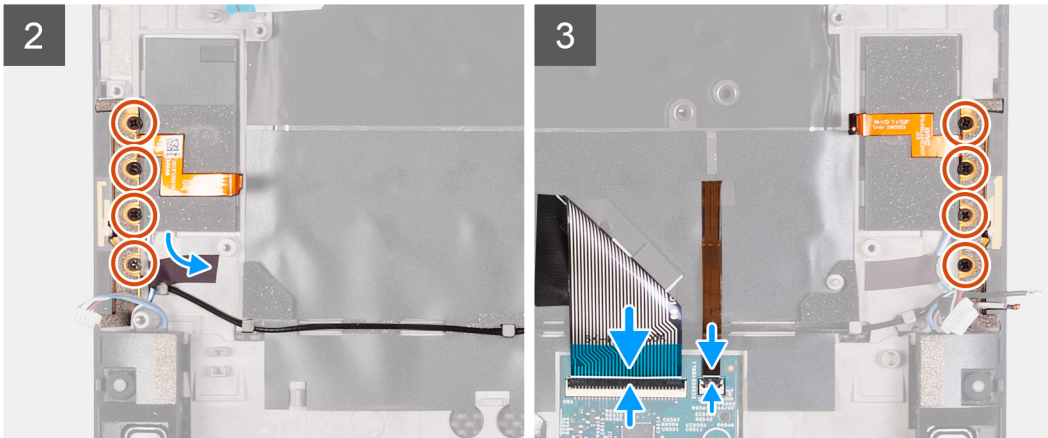
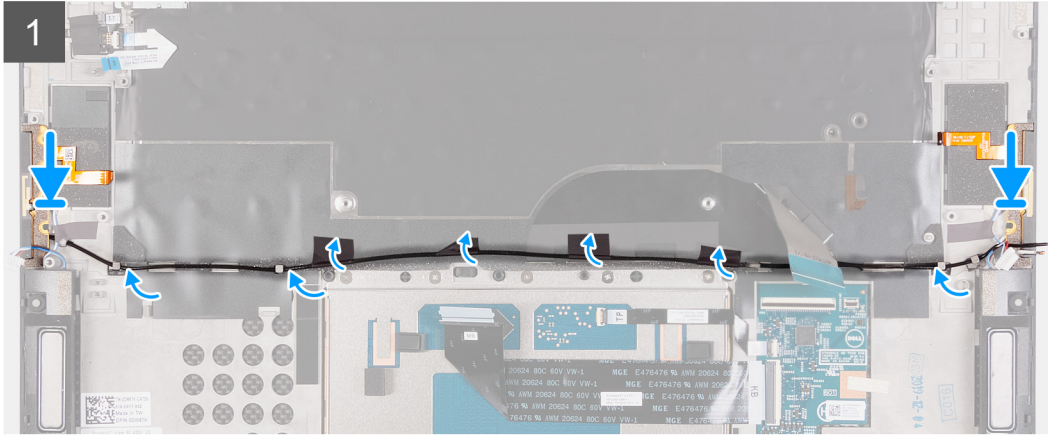
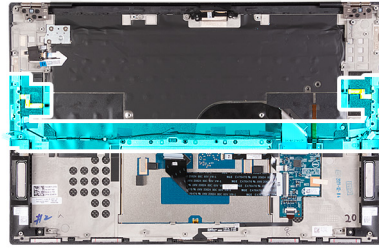
전제조건

이 작업 정보

다음 이미지는 안테나의 위치를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여줍니다.



8x
M2x2



단계

1. 안테나를 팜레스트 및 키보드 어셈블리의 슬롯에 넣습니다.
2. 안테나 케이블을 팜레스트 및 키보드 어셈블리의 라우팅 가이드를 통해 라우팅합니다.
3. 안테나 케이블을 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 테이프를 부착합니다.
4. 오른쪽 안테나의 나사 구멍을 팜레스트 및 키보드 어셈블리의 나사 구멍에 맞춥니다.
5. 오른쪽 안테나를 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 4개의 나사(M2x2)를 장착합니다.
6. 왼쪽 안테나의 나사 구멍을 팜레스트 및 키보드 어셈블리의 나사 구멍에 맞춥니다.
7. 왼쪽 안테나를 팜레스트 및 키보드 어셈블리에 고정하는 4개의 나사(M2x2)를 장착합니다.

다음 단계

1. 시스템 보드를 설치합니다.
2. 디스플레이 어셈블리를 설치합니다.
3. I/O 보드를 설치합니다.
4. 팬 2를 설치합니다.
5. 팬 1을 설치합니다.
6. 방열판을 설치합니다.
 - ① **노트:** 시스템 보드는 방열판이 부착된 상태로 함께 제거하거나 설치할 수 있습니다. 이렇게 하면 절차가 단순화되고 시스템 보드와 방열판 간의 열 결합 손상이 방지됩니다.
7. M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 또는 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브를 SSD2 슬롯에 설치합니다.

8. M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 또는 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브를 SSD1 슬롯에 설치합니다.
9. 메모리 모듈을 설치합니다.
10. 배터리를 설치합니다.
11. 베이스 커버를 설치합니다.
12. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

손목 받침대 및 키보드 어셈블리

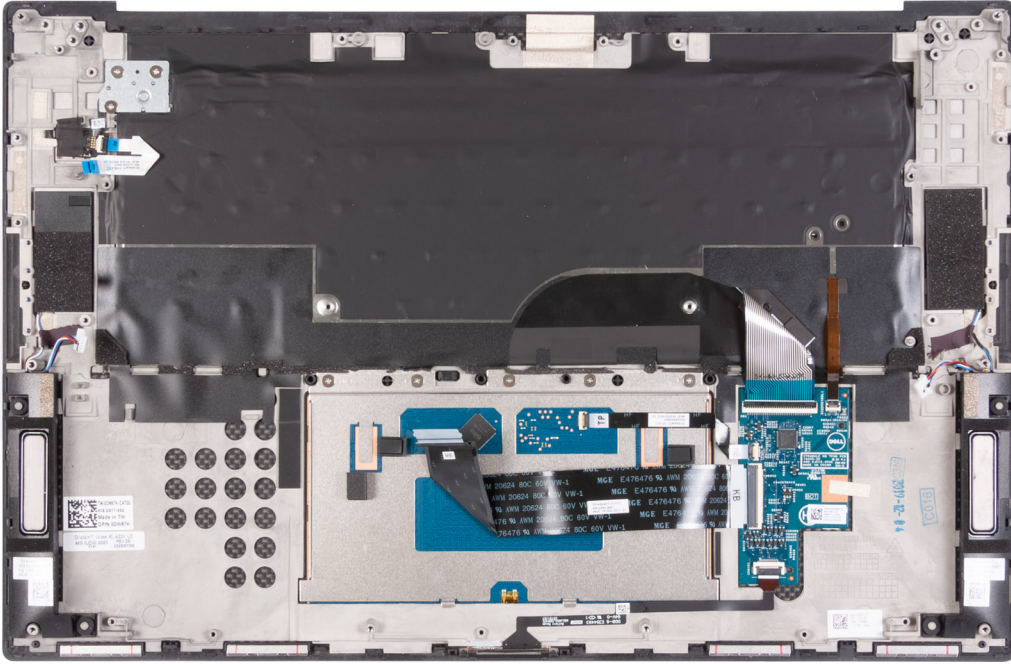
팜레스트 및 키보드 어셈블리 제거

전제조건

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
 - ① **노트:** 컴퓨터의 서비스 태그는 시스템 보드에 저장되어 있습니다. 시스템 보드를 교체한 후 BIOS 설정 프로그램에서 서비스 태그를 입력합니다.
 - ① **노트:** 시스템 보드를 교체하면 BIOS 설정 프로그램을 사용하여 변경된 BIOS 변경사항이 모두 제거됩니다. 시스템 보드를 교체한 후 적절히 변경합니다.
 - ① **노트:** 시스템 보드에서 케이블을 분리하기 전에 커넥터의 위치를 기록하여 시스템 보드를 교체한 후에 정확하게 다시 연결할 수 있도록 합니다.
2. 베이스 커버를 제거합니다.
3. 배터리를 제거합니다.
4. 메모리 모듈을 제거합니다.
5. M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 또는 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브를 SSD1 슬롯에서 제거합니다.
6. M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브 또는 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브를 SSD2 슬롯에서 제거합니다.
7. 방열판을 분리합니다.
 - ① **노트:** 시스템 보드는 방열판이 부착된 상태로 함께 제거하거나 설치할 수 있습니다. 이렇게 하면 절차가 단순화되고 시스템 보드와 방열판 간의 열 결합 손상이 방지됩니다.
8. 팬 1을 제거합니다.
9. 팬 2를 제거합니다.
10. I/O 보드를 분리합니다.
11. 디스플레이 어셈블리를 제거합니다.
12. 시스템 보드를 제거합니다.
13. 안테나를 제거합니다.

이 작업 정보

다음 이미지는 팜레스트 및 키보드 어셈블리를 나타내고 제거 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



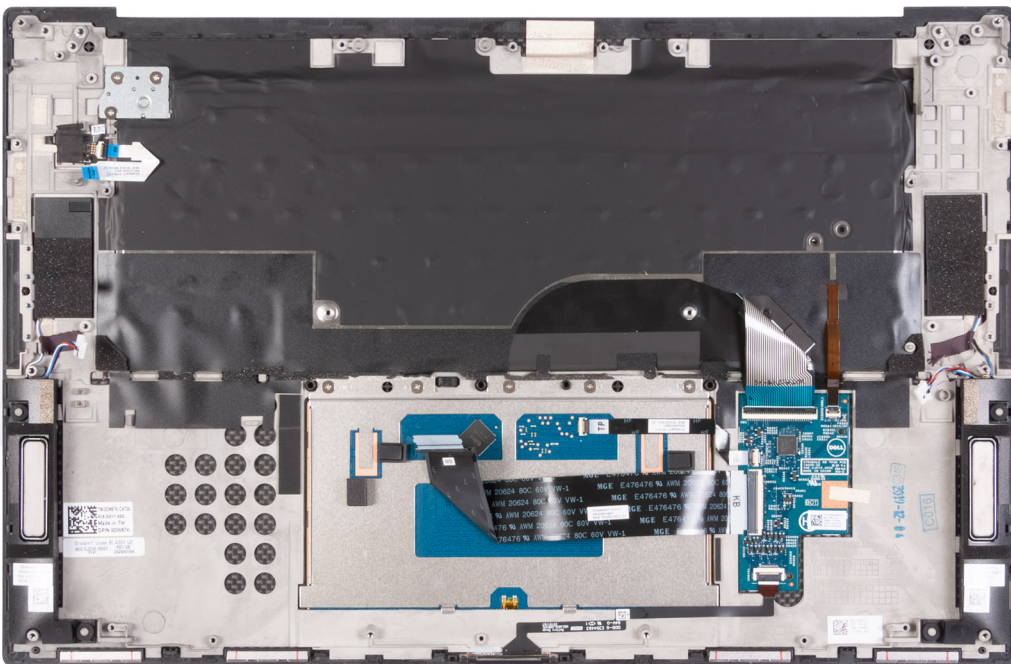
사전 요구 사항에 명시된 단계를 수행하고 나면 손목 받침대 및 키보드 어셈블리가 남습니다.

팜레스트 및 키보드 어셈블리 설치

전제조건

이 작업 정보


다음 이미지는 손목 받침대 및 키보드 어셈블리를 나타내고 설치 절차를 시각적으로 보여 줍니다.



단계

팜레스트 및 키보드 어셈블리를 평평한 표면에 놓습니다.

다음 단계

1. [안테나](#)를 설치합니다.
2. [시스템 보드](#)를 설치합니다.
3. [디스플레이 어셈블리](#)를 설치합니다.
4. [I/O 보드](#)를 설치합니다.
5. [팬 2](#)를 설치합니다.
6. [팬 1](#)을 설치합니다.
7. [방열판](#)을 설치합니다.
 **노트:** 시스템 보드는 방열판이 부착된 상태로 함께 제거하거나 설치할 수 있습니다. 이렇게 하면 절차가 단순화되고 시스템 보드와 방열판 간의 열 결합 손상이 방지됩니다.
8. [M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브](#) 또는 [M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브](#)를 SSD2 슬롯에 설치합니다.
9. [M.2 2230 솔리드 스테이트 드라이브](#) 또는 [M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브](#)를 SSD1 슬롯에 설치합니다.
10. [메모리 모듈](#)을 설치합니다.
11. [배터리](#)를 설치합니다.
12. [베이스 커버](#)를 설치합니다.
13. [컴퓨터 내부 작업을 마친 후에](#)의 절차를 따릅니다.

문제 해결

SupportAssist 진단

이 작업 정보

SupportAssist 진단(이전의 ePSA 진단) 프로그램은 하드웨어 전체 검사를 수행합니다. SupportAssist 진단 프로그램은 BIOS에 내장되어 있으며 BIOS에 의해 내부적으로 실행됩니다. SupportAssist 진단 프로그램은 특정 디바이스 그룹 또는 디바이스에 대해 일련의 옵션을 제공합니다. 이를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 자동으로 테스트 또는 상호 작용 모드를 실행합니다.
- 테스트를 반복합니다.
- 테스트 결과를 표시 또는 저장합니다.
- 테스트를 실행하여 추가 테스트 옵션을 소개하고 장애가 발생한 디바이스에 대한 추가 정보를 제공합니다.
- 테스트가 성공적으로 완료되었는지를 나타내는 상태 메시지를 보냅니다.
- 테스트 도중 문제가 발생했는지를 나타내는 오류 메시지를 보냅니다.

① 노트: 일부 테스트는 특정 디바이스를 위한 것이며 사용자 상호 작용이 필요합니다. 진단 테스트를 수행할 때는 컴퓨터 앞에 있어야 합니다.

자세한 정보는 [SupportAssist 부팅 전 시스템 성능 확인](#)을 참조하십시오.

시스템 진단 표시등

배터리 상태 표시등

전원 및 배터리 충전 상태를 나타냅니다.

솔리드 화이트 - 전원 어댑터가 연결되어 있고 배터리 잔량이 5% 이상입니다.

주황색 - 컴퓨터가 배터리로 실행 중이고 배터리 잔량이 5% 미만입니다.

꺼짐

- 전원 어댑터가 연결되어 있고 배터리가 완전히 충전되었습니다.
- 컴퓨터가 배터리로 실행 중이고 배터리 잔량이 5% 이상입니다.
- 컴퓨터가 대기 모드, 최대 절전 모드 또는 꺼져 있습니다.

오류를 나타내는 경고음 코드와 함께 전원 및 배터리 상태 표시등이 주황색으로 깜박입니다.

예를 들어, 전원 및 배터리 상태 표시등이 주황색으로 2번 깜박인 다음 일시 중지되고, 이어서 흰색으로 3번 깜빡인 다음 일시 중지됩니다. 이 2, 3 패턴은 컴퓨터가 꺼지면서 메모리 또는 RAM이 감지되지 않음을 나타낼 때까지 계속됩니다.

다음 표는 전원 및 배터리 상태 표시등 패턴과 관련한 문제를 설명합니다.

표 4. LED 코드

진단 표시등 코드	문제 설명
1,1	TPM 탐지 장애
1,2	복구할 수 없는 SPI 플래시 장애
1,5	i-Fuse 장애
1,6	EC 내부 장애
2,1	프로세서 오류
2,2	시스템 보드: BIOS 또는 ROM(읽기 전용 메모리) 장애
2,3	메모리 또는 RAM(Random-Access Memory)이 감지되지 않음

표 4. LED 코드 (계속)

진단 표시등 코드	문제 설명
2,4	메모리 또는 RAM(Random-Access Memory) 장애
2,5	잘못된 메모리 설치
2,6	시스템 보드 또는 칩셋 오류
2,7	디스플레이 장애 - SBIOS 메시지
2,8	디스플레이 장애 - 전원 레일 장애의 EC 탐지
3,1	코인 셀 배터리 장애
3,2	PCI/비디오 카드/칩 장애
3,4	복구 이미지를 찾았지만 유효하지 않음
3,5	전원 레일 장애
3,6	시스템 BIOS 플래시 불안전
3,7	ME(Management Engine) 오류
4,1	메모리 DIMM: 전원 레일 장애
4.2	프로세서 전원 케이블: 연결 장애

카메라 상태 표시등: 카메라가 사용 중인지 여부를 나타냅니다.

- 솔리드 화이트 - 카메라가 사용 중입니다.
- 꺼짐 - 카메라가 사용 중이 아닙니다.

Caps Lock 상태 표시등: Caps Lock가 활성화되어 있는지 또는 비활성화되어 있는지 여부를 나타냅니다.

- 솔리드 화이트 - <Caps Lock> 키가 활성화되어 있습니다.
- 꺼짐 - <Caps Lock> 키가 비활성화되어 있습니다.

시스템 보드 M-BIST(Built-in Self Test)

이 작업 정보

M-BIST는 시스템 보드의 EC(Embedded Controller) 장애에 대한 진단 정확도를 향상시키는 내장 자체 테스트 진단 툴입니다. M-BIST는 POST 전에 수동으로 시작해야 하며 비활성 시스템에서도 실행할 수 있습니다.

시스템 보드 M-BIST(Built-in Self Test)를 호출하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. <M> 키와 전원 버튼을 모두 길게 눌러 M-BIST를 시작합니다.
2. 시스템 보드 장애가 있는 경우 배터리 상태 표시등이 주황색으로 켜집니다.
3. 시스템 보드를 장착하면 문제가 수정됩니다.

① 노트: 시스템 보드가 올바르게 작동하면 배터리 상태 LED가 켜지지 않습니다.

운영 체제 복구

컴퓨터가 반복 시도 후에도 운영 체제로 부팅할 수 없는 경우, Dell SupportAssist OS 복구를 자동으로 시작합니다.

Dell SupportAssist OS 복구는 Windows 10 운영 체제와 함께 설치되는 모든 Dell 컴퓨터에 사전 설치되어 있는 독립 실행형 툴입니다. 컴퓨터가 운영 체제로 부팅하기 전에 발생할 수 있는 문제를 진단하고 해결할 수 있는 툴로 구성됩니다. 이 툴을 통해 하드웨어 문제를 진단하거나, 컴퓨터를 수리하거나, 파일을 백업하거나, 출하 시 상태로 컴퓨터를 복원할 수 있습니다.

소프트웨어 또는 하드웨어 장애로 인해 컴퓨터가 기본 운영 체제로 부팅할 수 없을 때 컴퓨터 문제를 해결하고 수정하기 위해 Dell Support 웹사이트에서 이 툴을 다운로드할 수도 있습니다.

Dell SupportAssist OS 복구에 대한 자세한 내용은 <https://www.dell.com/support/article/sln317666/>을 참조하십시오.

BIOS 플래싱

이 작업 정보

사용 가능한 업데이트가 있거나 시스템 보드 교체 후 BIOS를 플래싱(업데이트)해야 할 수 있습니다.

다음 단계에 따라 BIOS를 플래시합니다.

⚠ 경고: BIOS를 업데이트하기 전에 BitLocker를 비활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 업데이트 후에 BitLocker 복구 키가 필요합니다.

단계

1. 컴퓨터를 켭니다.
2. www.dell.com/support로 이동합니다.
3. **제품 지원**을 클릭해 컴퓨터의 서비스 태그를 입력한 후 **제출**을 클릭합니다.
📌 노트: 서비스 태그가 없는 경우 수동으로 자동 검색 기능을 사용하여 컴퓨터 모델을 탐색합니다.
4. **Drivers & Downloads(드라이버 및 다운로드) > Find it myself(직접 찾기)**를 클릭합니다.
5. 컴퓨터에 설치된 운영 체제를 선택합니다.
6. 페이지를 아래로 스크롤하여 **BIOS**를 확장할 수 있습니다.
7. **Download(다운로드)**을 클릭하여 컴퓨터 BIOS의 최신 버전을 다운로드합니다.
8. 다운로드가 완료된 후 BIOS 업데이트 파일을 저장한 폴더로 이동합니다.
9. BIOS 업데이트 파일 아이콘을 두 번 클릭하고 화면의 지침을 따릅니다.

다음 단계

F12 원타임 부팅 메뉴에서 BIOS 플래싱에 대한 자세한 내용은 <https://www.dell.com/support/article/sln305230>을 참조하십시오.

BIOS 플래시(USB 키)

단계

1. "BIOS 플래시"에 있는 1~7단계의 절차에 따라 최신 BIOS 설정 프로그램 파일을 다운로드합니다.
2. 부팅 가능한 USB 드라이브를 생성합니다. 자세한 정보는 www.dell.com/support에서 기술 자료 기사 [SLN143196](https://www.dell.com/support/article/sln143196)을 참조하십시오.
3. BIOS 설정 프로그램 파일을 부팅 가능한 USB 드라이브에 복사합니다.
4. 부팅 가능한 USB 드라이브를 BIOS 업데이트가 필요한 컴퓨터에 연결합니다.
5. 컴퓨터를 재시작하고 Dell 로고가 화면에 표시되면 **F12** 키를 누릅니다.
6. **One Time Boot Menu(원타임 부팅 메뉴)**에서 USB 드라이브로 부팅합니다.
7. BIOS 설정 프로그램 파일 이름을 입력하고 **Enter** 키를 누릅니다.
8. **BIOS Update Utility(BIOS 업데이트 유틸리티)**가 나타납니다. 화면의 지침을 따라 BIOS 업데이트를 완료합니다.


백업 미디어 및 복구 옵션

Windows에 발생할 수 있는 문제를 해결하고 수정하려면 복구 드라이브를 생성하는 것이 좋습니다. Dell은 사용자의 Dell PC에서 Windows 운영 체제를 복구하기 위해 여러 옵션을 제안합니다. 자세한 정보는 [Dell Windows 백업 미디어 및 복구 옵션](#)을 참조하십시오.

Wi-Fi 전원 주기

이 작업 정보

Wi-Fi 연결 문제로 인해 컴퓨터에서 인터넷에 액세스할 수 없는 경우 Wi-Fi 전원 주기 절차를 수행할 수 있습니다. 다음 절차는 Wi-Fi 전원 주기를 수행하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

 **노트:** 일부 ISP(Internet Service Providers)는 모뎀/라우터 콤보 디바이스를 제공합니다.

단계

1. 컴퓨터를 끕니다.
2. 모뎀을 끕니다.
3. 무선 라우터를 끕니다.
4. 약 30초간 기다립니다.
5. 무선 라우터를 켵니다.
6. 모뎀을 켵니다.
7. 컴퓨터를 켵니다.


잔류 전원 방출

이 작업 정보

잔류 전원은 전원을 끄고 배터리가 시스템 보드에서 연결 해제된 후에도 컴퓨터에 남아 있는 정전기입니다. 다음 절차는 잔류 전원을 방출하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

단계

1. 컴퓨터를 끕니다.
2. **베이스 커버**를 제거합니다.


 **노트:** 배터리를 시스템 보드에서 연결 해제해야 합니다(**베이스 커버 제거**의 3단계 참조)

3. 약 15초간 전원 버튼을 눌러 잔류 전원을 방전시킵니다.
4. **베이스 커버**를 설치합니다.
5. 컴퓨터를 켵니다.

도움말 보기

Dell에 문의하기

전제조건

 **노트:** 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 구매 송장, 포장 명세서, 청구서 또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 확인할 수 있습니다.

이 작업 정보

Dell은 다양한 온라인 및 전화 기반 지원과 서비스 옵션을 제공합니다. 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비스는 소재 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell에 문의하려면

단계

1. **Dell.com/support**로 이동합니다.
2. 지원 카테고리를 선택합니다.
3. 페이지 맨 아래에 있는 **국가/지역 선택** 드롭다운 메뉴에서 국가 또는 지역을 확인합니다.
4. 필요에 따라 해당 서비스 또는 지원 링크를 선택합니다.